DACx3608 オクタル、10 ビットまたは 8 ビット、I²C™ インターフェイス、超小型 3 × 3 WQFN パッケージのバッファ付き電圧出力 DAC

1 特長

- ±1LSB INL および DNL
- 広い動作範囲
  - 電源: 1.8V～5.5V
  - 温度範囲:-40˚C～+125˚C
- I²C™ シリアル・インターフェイス
  - Standard、Fast、Fast+ モード
  - VIH:2.4V (V_{DD} = 5.5V)
- $\overline{\text{LDAC}}$ ピンによる出力の同時更新
- 超低消費電力：0.1mA / チャネル (1.8V)
- 低消費電力起動モード：出力を 10K 状態にパワーダウン
- 超小型パッケージ
  - 16 ピン WQFN (3mm × 3mm)

2 アプリケーション

- プログラム可能な電源
- プログラマブル・ウィンドウ・コンパレータ
- ディスプレイ・パネルのVCOMバイアス印加
- 多機能プリンタのレーザー・ドライバ
- オート・フォーカスのデジタル・カメラ用レンズ
- ATM、現金計数器、バーコード・リーダー
- IPネットワーク・カメラ、プロジェクタ

3 概要

DAC53608 および DAC43608 (DACx3608) は、低消費電力、8 チャネル、10 ビットまたは 8 ビットの電圧出力デジタル / アナログ・コンバータ (DAC) です。DACx3608 は 1.8V～5.5V の広い電源電圧範囲にわたって単調性を維持するように設計されています。外部リファレンスを使用して、1.8V～5.5V のフルスケール出力電圧範囲に対応する一方、消費する静止電流はチャネル当たり 0.1mA です。また、チャネルごとにユーザーがプログラム可能なパワーダウン・レジスタも内蔵しています。これらのレジスタにより、DAC 出力バッファは起動時は 10K 状態にパワーダウンされ、これらの出力バッファにパワーアップ・コマンドが発行されるまで、この状態を維持します。

低静止電流で電源電圧範囲が広く、チャネル単位のパワーダウン・オプションを備えた DACx3608 は、低消費電力のバッテリ駆動システムに最適です。

I²C™ インターフェイスで通信し、I²C™ の Standard モード (100kbps)、Fast モード (400kbps)、Fast+ モード (1Mbsp) をサポートしています。また、DAC を同時に更新できるロード DAC ($\overline{\text{LDAC}}$) ピンも備えています。

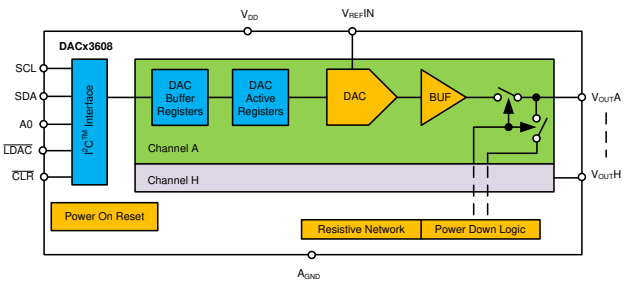
DACx3608 は小型の 3mm × 3mm、16 ピン WQFN パッケージで供給されます。これらのデバイスは、拡張産業用温度範囲の-40°C～+125°Cで完全に動作が規定されています。

製品情報(1)

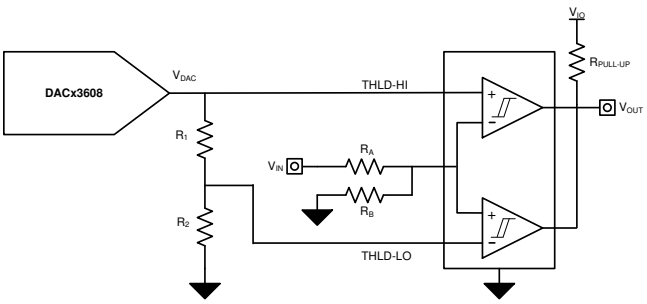
型番	パッケージ	本体サイズ(公称)
DAC53608	WQFN (16)	3.00mm×3.00mm
DAC43608	WQFN (16)	3.00mm×3.00mm

(1) 利用可能なすべてのパッケージについては、このデータシートの末尾にある注文情報を参照してください。

ブロック概略図



プログラマブル・ウィンドウ・コンパレータ



英語版のTI製品についての情報を翻訳したこの資料は、製品の概要を確認する目的で便宜的に提供しているものです。該当する正式な英語版の最新情報は、www.ti.comで閲覧でき、その内容が常に優先されます。TIでは翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。実際の設計などの前には、必ず最新版の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。

English Data Sheet: SLASEQ4

目次

1 特長 ... 1
2 アプリケーション ... 1
3 概要 ... 1
4 改訂履歴 ... 2
5 デバイス比較表 ... 3
6 ピン構成および機能 ... 3
7 仕様 ... 4
7.1 絶対最大定格 ... 4
7.2 ESD定格 ... 4
7.3 推奨動作条件 ... 4
7.4 熱特性 ... 4
7.5 電気的特性 ... 5
7.6 タイミング要件：I²C™ Standard モード ... 7
7.7 タイミング要件：I²C™ Fast モード ... 7
7.8 タイミング要件：I²C™ Fast+ モード ... 8
7.9 タイミング要件：ロジック ... 8
7.10 代表的特性：1.8V ... 10
7.11 代表的特性：5.5V ... 12
7.12 代表的特性 ... 17
7.13 代表的特性 ... 18
8 詳細説明 ... 19
8.1 概要 ... 19
8.2 機能ブロック図 ... 19
8.3 機能説明 ... 20
8.4 デバイスの機能モード ... 21
8.5 プログラミング ... 22
8.6 レジスタ・マップ ... 28
9 アプリケーションと実装 ... 31
9.1 アプリケーション情報 ... 31
9.2 代表的なアプリケーション ... 31
10 電源に関する推奨事項 ... 34
11 レイアウト ... 35
11.1 レイアウトの注意点 ... 35
11.2 レイアウト例 ... 35
12 デバイスおよびドキュメントのサポート ... 36
12.1 ドキュメントのサポート ... 36
12.2 関連リンク ... 36
12.3 ドキュメントの更新通知を受け取る方法 ... 36
12.4 コミュニティ・リソース ... 36
12.5 商標 ... 36
12.6 静電気放電に関する注意事項 ... 36
12.7 Glossary ... 36
13 メカニカル、パッケージ、および注文情報 ... 37

4 改訂履歴

2018年10月発行のものから更新 **Page**

- 事前情報から量産データに 変更 ... 1

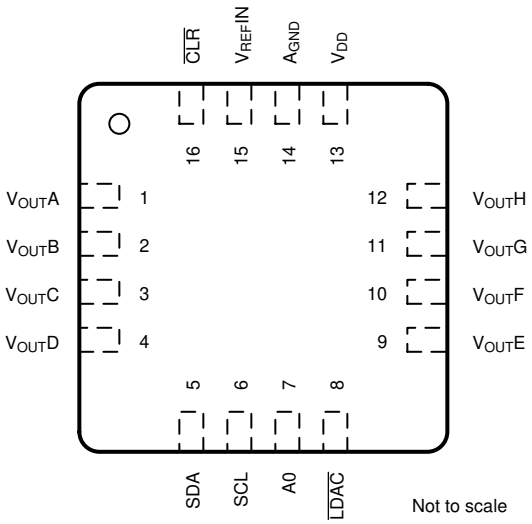
Copyright © 2018, Texas Instruments Incorporated

5 デバイス比較表

デバイス	分解能
DAC53608	10 ビット
DAC43608	8 ビット

6 ピン構成および機能

RTE パッケージ
16ピンWQFN
上面図



端子機能

端子		I/O	説明
名前	番号		
A0	7	I	4 ステート・アドレス入力
A_{GND}	14	GND	デバイスの全回路のグランド基準点
$\overline{CLR}$	16	I	非同期クリア・ピン (アクティブ Low)
$\overline{LDAC}$	8	I	同時出力更新用ロード DAC ピン (アクティブ Low)
SCL	6	I	シリアル・インターフェイス・クロック
SDA	5	I/O	入力レジスタにデータをクロック入出力します。このピンは双方向、オープン・ドレインのデータ・ラインで、外付けプルアップ抵抗で電源に接続する必要があります。
V_{DD}	13	PWR	アナログ電源電圧 (1.8V～5.5V)
$V_{OUT}A$	1	O	DAC A からのアナログ出力電圧
$V_{OUT}B$	2	O	DAC B からのアナログ出力電圧
$V_{OUT}C$	3	O	DAC C からのアナログ出力電圧
$V_{OUT}D$	4	O	DAC D からのアナログ出力電圧
$V_{OUT}E$	9	O	DAC E からのアナログ出力電圧
$V_{OUT}F$	10	O	DAC F からのアナログ出力電圧
$V_{OUT}G$	11	O	DAC G からのアナログ出力電圧
$V_{OUT}H$	12	O	DAC H からのアナログ出力電圧
$V_{REF}IN$	15	I/O	デバイスへのリファレンス入力

Copyright © 2018, Texas Instruments Incorporated

7 仕様

7.1 絶対最大定格

自由通気で動作温度範囲内(特に記述のない限り)(1)

		MIN	MAX	UNIT
入力電圧	A_{GND} に対する V_{DD}	–0.3	6	V
	A_{GND} に対する $V_{REF}IN$	–0.3	V_{DD} + 0.3	
	A_{GND} に対するデジタル入力	–0.3	V_{DD} + 0.3	
出力電圧	A_{GND} に対する V_{OUT}	–0.3	V_{DD} + 0.3	V
入力電流	ピンへの電流	–10	10	mA
温度	接合部温度、T_J	–40	150	°C
	保管温度、T_{stg}	–65	150	

(1) *絶対最大定格*を上回るストレスが加わった場合、デバイスに永続的な損傷が発生する可能性があります。これはストレスの定格のみについて示してあり、このデータシートの「*推奨動作条件*」に示された値を超える状態で本製品が正常に動作することを暗黙的に示すものではありません。絶対最大定格の状態に長時間置くと、本製品の信頼性に影響を与えることがあります。

7.2 ESD定格

			VALUE	UNIT
$V_{(ESD)}$	静電放電	人体モデル (HBM)、ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 準拠、すべてのピン(1)	±1000	V
		デバイス帯電モデル (CDM)、JEDEC 規格 JESD22-C101 準拠、すべてのピン(2)	±500	

(1) JEDEC のドキュメント JEP155 に、500V HBM では標準の ESD 管理プロセスで安全な製造が可能であると規定されています。[次の文はオプション、wiki を参照。] 必要な予防措置をとれば、HBM の ESD 耐圧が 500V 未満でも製造可能です。[次の文はオプション、wiki を参照。] ±WWWV や ±XXXV と表示されるピンは、より高い性能を備えています。
(2) JEDEC のドキュメント JEP157 に、250V CDM では標準の ESD 管理プロセスで安全な製造が可能であると規定されています。[次の文はオプション、wiki を参照。] 必要な予防措置をとれば、CDM の ESD 耐圧が 250V 未満でも製造可能です。[次の文はオプション、wiki を参照。] ±YYYV や ±ZZZV と表示されるピンは、より高い性能を備えています。

7.3 推奨動作条件

自由気流での動作温度範囲内(特に記述のない限り)

		MIN	NOM	MAX	UNIT
A_{GND} に対する V_{DD}	グランドに対する正電源電圧	1.8		5.5	V
A_{GND} に対する $V_{REF}IN$	グランドに対する基準入力電源電圧	1.8		V_{DD}	V
VIH	デジタル入力 High 電圧、1.8 ≤ V_{DD} ≤ 2.7	V_{DD} – 0.3			V
VIH	デジタル入力 High 電圧、2.7 < V_{DD} ≤ 5.5	2.4			V
VIL	デジタル入力 Low 電圧			0.5	V
T_A	周囲温度	–40		125	°C

7.4 熱特性

熱特性(1)		DACx3608 RTE (WQFN) 16 ピン	単位
$R_{\theta JA}$	接合部から周囲への熱抵抗	49	°C/W
$R_{\theta JC(top)}$	接合部からケース(上面)への熱抵抗	50	°C/W
$R_{\theta JB}$	接合部から基板への熱抵抗	24.1	°C/W
Ψ_{JT}	接合部から上面への熱特性	1.1	°C/W
Y_{JB}	接合部から基板への熱特性	24.1	°C/W
$R_{\theta JC(bot)}$	接合部からケース(底面)への熱抵抗	8.7	°C/W

(1) 新旧熱評価基準の詳細については、アプリケーション・レポート『*Semiconductor and IC Package Thermal Metrics*』(英語) を参照してください。

Copyright © 2018, Texas Instruments Incorporated

7.5 電気的特性

すべての最小値 / 最大値は T_A = –40°C ~ +125°C、すべての標準値は T_A = 25°C、1.8V ≤ V_{DD} ≤ 5.5V、V_{DD} ≥ 2.7V では V_{REF}IN = 2.5V、V_{DD} ≤ 2.7V では V_{REF}IN = 1.8V、A_{GND} に対する R_L = 5kΩ、A_{GND} に対する C_L = 200pF、V_{DD} または A_{GND} でのデジタル入力を条件として規定しています (特に記述のない限り)。

パラメータ		テスト条件	MIN	TYP	MAX	UNIT
安定動作						
	分解能	DAC53608	10			ビット
		DAC43608	8			
INL	相対精度(1)	DAC43608、2.7V ≤ V_{DD} ≤ 5.5V	–1		1	LSB
		DAC43608、1.8V ≤ V_{DD} ≤ 2.7V	–1		1	
		DAC53608、2.7V ≤ V_{DD} ≤ 5.5V	–1		1	
		DAC53608、1.8V ≤ V_{DD} ≤ 2.7V	–1		1	
DNL	微分非線形性(1)	DAC43608、2.7V ≤ V_{DD} ≤ 5.5V	–1		1	LSB
		DAC43608、1.8V ≤ V_{DD} ≤ 2.7V	–1		1	
		DAC53608、2.7V ≤ V_{DD} ≤ 5.5V	–1		1	
		DAC53608、1.8V ≤ V_{DD} ≤ 2.7V	–1		1	
	ゼロコード誤差	2.7V ≤ V_{DD} ≤ 5.5V、コード 0d を DAC に入力		6	12	mV
		1.8V ≤ V_{DD} ≤ 2.7V、コード 0d を DAC に入力		6	12	
	ゼロコード誤差温度係数			±5		µV/°C
	オフセット誤差(1)	2.7V ≤ V_{DD} ≤ 5.5V	–0.5	0.25	0.5	%FSR
		1.8V ≤ V_{DD} ≤ 2.7V	–0.5	0.25	0.5	
	オフセット誤差温度係数(1)			±0.0003		%FSR/°C
	ゲイン誤差(1)	2.7V ≤ V_{DD} ≤ 5.5V	–0.5	0.25	0.5	%FSR
		1.8V ≤ V_{DD} ≤ 2.7V	–0.5	0.25	0.5	
	ゲイン誤差温度係数(1)			±0.0004		%FSR/°C
	フルスケール誤差	2.7V ≤ V_{DD} ≤ 5.5V、コード 1023d を DAC に入力、ヘッドルームなし	–0.5	0.25	0.5	%FSR
		1.8V ≤ V_{DD} ≤ 2.7V、コード 1023d を DAC に入力、ヘッドルームなし	–1	0.5	1	
	フルスケール誤差温度係数			±0.0004		%FSR/°C
出力特性						
V_{OUT}X	出力電圧		0		5.5	V
C_L	容量性負荷(2)	R_L = 無限大			1	nF
		R_L = 5kΩ			2	
	負荷安定化	DAC ミッドスケール、-10mA ≤ I_{OUT} ≤ 10mA、V_{DD} = 5.5V		0.1		mV/mA
	短絡電流	V_{DD} = 1.8V、(チャネルごとに) フルスケール出力を A_{GND} に短絡またはゼロスケール出力を V_{DD} に短絡		10		mA
		V_{DD} = 2.7V、(チャネルごとに) フルスケール出力を A_{GND} に短絡またはゼロスケール出力を V_{DD} に短絡		25		
		V_{DD} = 5.5V、(チャネルごとに) フルスケール出力を A_{GND} に短絡またはゼロスケール出力を V_{DD} に短絡		50		
	出力電圧ヘッドルーム	V_{DD} に対して (DAC 出力無負荷)		0.05		V

(1) コード間のエンドポイント一致：コード 4 - コード 1016 は 10 ビット、コード 1 - コード 251 は 8 ビット。
(2) 量産では検査していません。

Copyright © 2018, Texas Instruments Incorporated

電気的特性 (continued)

すべての最小値 / 最大値は T_A = –40°C ~ +125°C、すべての標準値は T_A = 25°C、1.8V ≤ V_{DD} ≤ 5.5V、V_{DD} ≥ 2.7V では V_{REF}IN = 2.5V、V_{DD} ≤ 2.7V では V_{REF}IN = 1.8V、A_{GND} に対する R_L = 5kΩ、A_{GND} に対する C_L = 200pF、V_{DD} または A_{GND} でのデジタル入力を条件として規定しています (特に記述のない限り)。

パラメータ		テスト条件	MIN	TYP	MAX	UNIT
	出力電圧ヘッドルーム(2)	V_{DD} に対して (負荷電流 = 10mA@V_{DD} = 5.5V、負荷電流 = 3mA@V_{DD} = 2.7V、負荷電流 = 1mA@V_{DD} = 1.8V)、DAC コード = フルスケール	10			%FSR
Z_O	DC 出力インピーダンス	DAC ミッドスケール		0.25		Ω
		DAC コード 4d		0.25		
		DAC コード 1016		0.26		
DC-PSRR	電源電圧変動除去比 (DC)	DAC ミッドスケール、V_{DD} = 5V ± 10%		0.25		mV/V
動的特性						
t_{sett}	出力電圧セトリング時間	10%FSR に対する 1/4 から 3/4 スケールおよび 3/4 から 1/4 スケールへの変化時のセトリング、R_L = 5kΩ、C_L = 200pF、V_{DD} = 5.5V		10		µs
SR	スルーレート	R_L = 5kΩ、C_L = 200pF、V_{DD} = 5.5V		0.6		V/µs
	電源オン時のグリッチ振幅	R_L = 5kΩ、C_L = 200pF		110		mV
V_n	出力ノイズ	0.1Hz ~ 10Hz、DAC ミッドスケール、V_{DD} = 5.5V		40		μV_{pp}
V_n	出力ノイズ	帯域幅 0.1Hz ~ 100kHz、DAC ミッドスケール、V_{DD} = 5.5V		0.05		mV_{rms}
V_n	出力ノイズ密度	1kHz で測定、DAC ミッドスケール、V_{DD} = 5.5V		0.2		µV/√Hz
		10kHz で測定、DAC ミッドスケール、V_{DD} = 5.5V		0.2		
AC-PSRR	電源電圧変動除去比 (AC)	200mV 50/60Hz の正弦波を電源電圧に重畳、DAC ミッドスケール		–71		dB
	チャネル間 AC クロストーク	隣接チャネルのフルスケール・スイング		1.5		nV-s
	チャネル間 DC クロストーク	全チャネルのフルスケール・スイング、ゼロまたはフルスケールでチャネルを測定		0.05		LSB
	コード書き換えによるグリッチ・インパルス	ミッドコード付近の ±1LSB の変化 (フィードスルーを含む)		10		nV-s
	コード書き換えによるグリッチ・インパルス振幅	ミッドコード付近の ±1LSB の変化 (フィードスルーを含む)		25		mV
電圧リファレンス入力						
	リファレンス入力インピーダンス	全チャネル電源オン		12.5		kΩ
	リファレンス入力容量			50		pF
デジタル入力						
	デジタル・フィードスルー	SCLK = 1MHz、ミッドスケールで DAC 出力静止		20		nV-s
	ピン容量	ピン単位		10		pF
電源要件						
IV_{DD}	V_{DD} に流れ込む電流	通常モード、全 DAC フルスケール、SPI 静止。		3	5	mA
IV_{DD}	V_{DD} に流れ込む電流	全 DAC パワーダウン		50		µA

Copyright © 2018, Texas Instruments Incorporated

7.6 タイミング要件：I²C™ Standard モード

すべての入力信号は VIL から V_{DD} の 70% に対して、1.8V ≤ V_{DD} ≤ 5.5V、1.8V ≤ V_{REF}IN ≤ V_{DD}、–40°C ≤ T_A ≤ +125°C、1.8V ≤ V_{DD} ≤ 2.7V では Vpull up = V_{DD}、2.7V ≤ V_{DD} ≤ 5.5V では Vpull up = 2.7V または V_{DD} を条件として時間測定しています。

		MIN	NOM	MAX	UNIT
f_{SCLK}	SCLK 周波数			0.1	MHz
t_{BUF}	ストップ条件とスタート条件間のバス解放時間	4.7			µs
t_{HDSTA}	再スタート条件生成後のホールド時間	4			µs
t_{SUSTA}	再スタート条件セットアップ時間	4.7			µs
t_{SUSTO}	ストップ条件セットアップ時間	4			µs
t_{HDDAT}	データ· ホールド時間	0			ns
t_{SUDAT}	データ· セットアップ時間	250			ns
t_{LOW}	SCL クロックの Low 期間	4700			ns
t_{HIGH}	SCL クロックの High 期間	4700			ns
t_F	クロック / データの立ち下がり時間			300	ns
t_R	クロック / データの立ち上がり時間			1000	ns

7.7 タイミング要件：I²C™ Fast モード

すべての入力信号は VIL から V_{DD} の 70% に対して、1.8V ≤ V_{DD} ≤ 5.5V、1.8V ≤ V_{REF}IN ≤ V_{DD}、–40°C ≤ T_A ≤ +125°C、1.8V ≤ V_{DD} ≤ 2.7V では Vpull up = V_{DD}、2.7V ≤ V_{DD} ≤ 5.5V では Vpull up = 2.7V または V_{DD} を条件として時間測定しています。

		MIN	NOM	MAX	UNIT
f_{SCLK}	SCLK 周波数			0.4	MHz
t_{BUF}	ストップ条件とスタート条件間のバス解放時間	1.3			µs
t_{HDSTA}	再スタート条件生成後のホールド時間	0.6			µs
t_{SUSTA}	再スタート条件セットアップ時間	0.6			µs
t_{SUSTO}	ストップ条件セットアップ時間	0.6			µs
t_{HDDAT}	データ· ホールド時間	0			ns
t_{SUDAT}	データ· セットアップ時間	100			ns
t_{LOW}	SCL クロックの Low 期間	1300			ns
t_{HIGH}	SCL クロックの High 期間	600			ns
t_F	クロック / データの立ち下がり時間			300	ns
t_R	クロック / データの立ち上がり時間			300	ns

Copyright © 2018, Texas Instruments Incorporated

7.8 タイミング要件：I²C™ Fast+ モード

すべての入力信号は VIL から V_{DD} の 70% に対して、1.8V ≤ V_{DD} ≤ 5.5V、1.8V ≤ V_{REF}IN ≤ V_{DD}、–40°C ≤ T_A ≤ +125°C、1.8V ≤ V_{DD} ≤ 2.7V では Vpull up = V_{DD}、2.7V ≤ V_{DD} ≤ 5.5V では Vpull up = 2.7V または V_{DD} を条件として時間測定しています。

		MIN	NOM	MAX	UNIT
f_{SCLK}	SCL 周波数			1	MHz
t_{BUF}	ストップ条件とスタート条件間のバス解放時間	0.5			µs
t_{HDSTA}	再スタート条件生成後のホールド時間	0.26			µs
t_{SUSTA}	再スタート条件セットアップ時間	0.26			µs
t_{SUSTO}	ストップ条件セットアップ時間	0.26			µs
t_{HDDAT}	データ· ホールド時間	0			ns
t_{SUDAT}	データ· セットアップ時間	50			ns
t_{LOW}	SCL クロックの Low 期間	0.5			µs
t_{HIGH}	SCL クロックの High 期間	0.26			µs
t_F	クロック / データの立ち下がり時間			120	ns
t_R	クロック / データの立ち上がり時間			120	ns

7.9 タイミング要件：ロジック

すべての入力信号は VIL から V_{DD} の 70% に対して、1.8V ≤ V_{DD} ≤ 5.5V、1.8V ≤ V_{REF}IN ≤ V_{DD}、–40°C ≤ T_A ≤ +125°C、1.8V ≤ V_{DD} ≤ 2.7V では Vpull up = V_{DD}、2.7V ≤ V_{DD} ≤ 5.5V では Vpull up = 2.7V または V_{DD} を条件として時間測定しています。

		MIN	NOM	MAX	UNIT
t_{LDACAH}	SCL 立ち下がりエッジから $\overline{LDAC}$ 立ち上がりエッジまで、1.7V ≤ V_{DD} ≤ 2.7V	20			ns
t_{LDACAH}	SCL 立ち下がりエッジから $\overline{LDAC}$ 立ち上がりエッジまで、2.7V < V_{DD} ≤ 5.5V	20			ns
t_{LDACAL}	$\overline{LDAC}$ 立ち下がりエッジから SCL 立ち下がりエッジまで、1.7V ≤ V_{DD} ≤ 5.5V	10			クロック· サイクル
t_{LDACSH}	SCL 立ち下がりエッジから $\overline{LDAC}$ 立ち上がりエッジまで、1.7V ≤ V_{DD} ≤ 2.7V	80			ns
t_{LDACSH}	SCL 立ち下がりエッジから $\overline{LDAC}$ 立ち上がりエッジまで、2.7V < V_{DD} ≤ 5.5V	50			ns
t_{LDACSL}	SCL 立ち下がりエッジから $\overline{LDAC}$ 立ち下がりエッジまで、1.7V ≤ V_{DD} ≤ 2.7V	20			ns
t_{LDACSL}	SCL 立ち下がりエッジから $\overline{LDAC}$ 立ち下がりエッジまで、2.7V ≤ V_{DD} ≤ 5.5V	20			ns
t_{LDACW}	$\overline{LDAC}$ Low 時間、1.7V ≤ V_{DD} < 2.7V	30			ns
t_{LDACW}	$\overline{LDAC}$ Low 時間、2.7V ≤ V_{DD} ≤ 5.5V	60			ns
t_{CLRW}	$\overline{CLR}$ Low 時間、1.7V ≤ V_{DD} < 2.7V	30			ns
t_{CLRW}	$\overline{CLR}$ Low 時間、2.7V ≤ V_{DD} ≤ 5.5V	60			ns

Copyright © 2018, Texas Instruments Incorporated

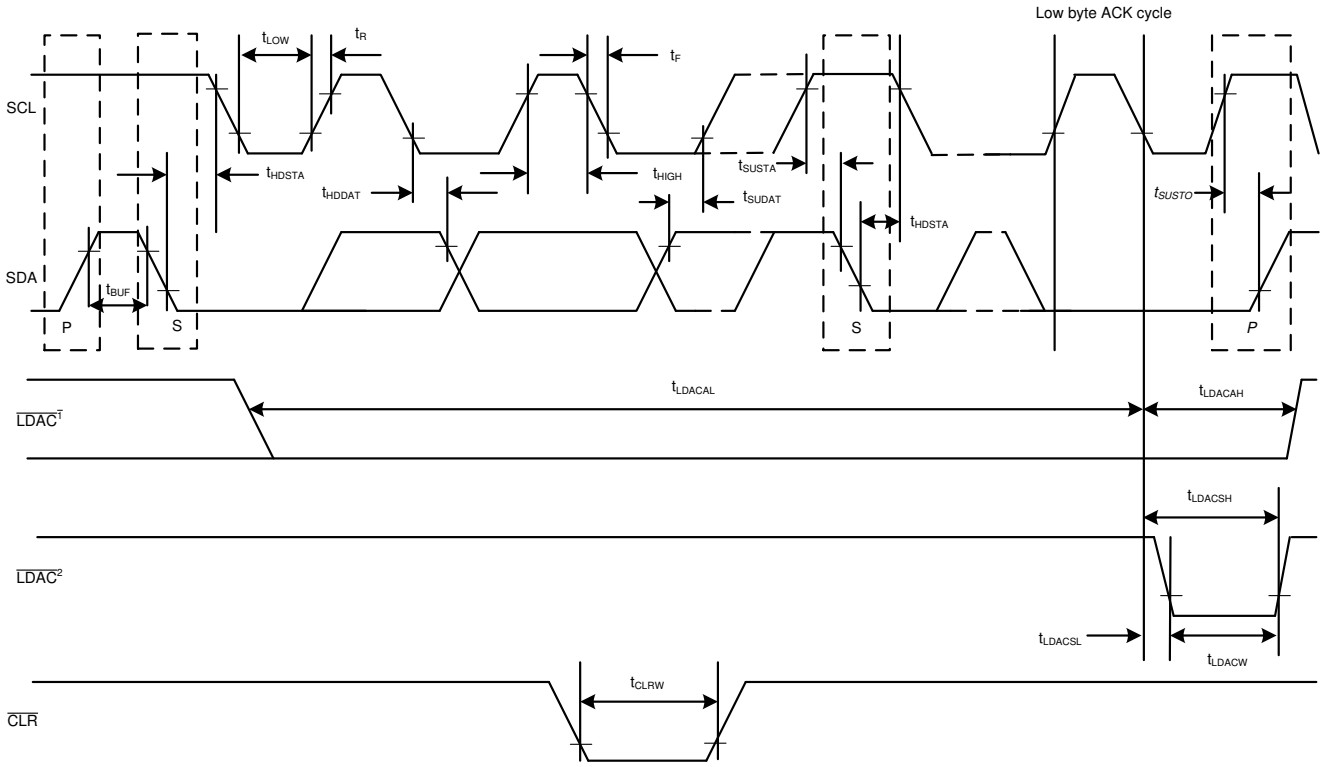


図 1. シリアル・インターフェイス・タイミング図

7.10 代表的特性：1.8V

T_A = 25°C、V_{DD} = 1.8V、リファレンス = 1.8V、DAC 出力は無負荷 (特に記述のない限り)

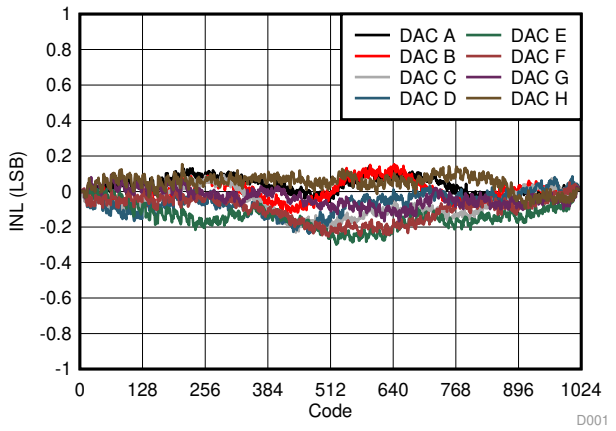


図 2. 積分直線性誤差とデジタル入力コードとの関係

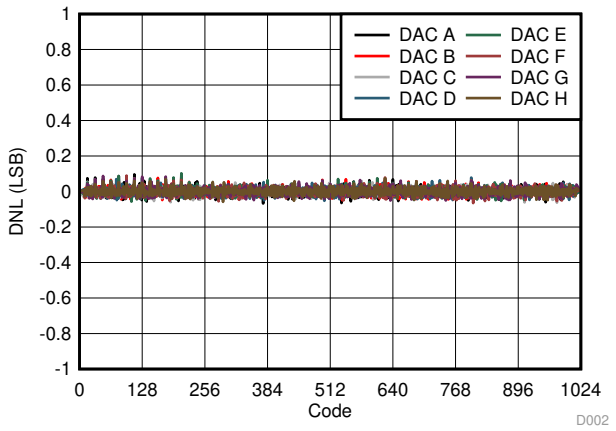


図 3. 微分直線性誤差とデジタル入力コードとの関係

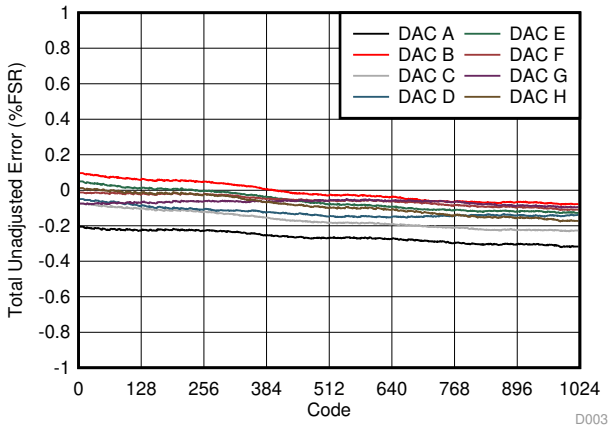


図 4. 総合未調整誤差とデジタル入力コードとの関係

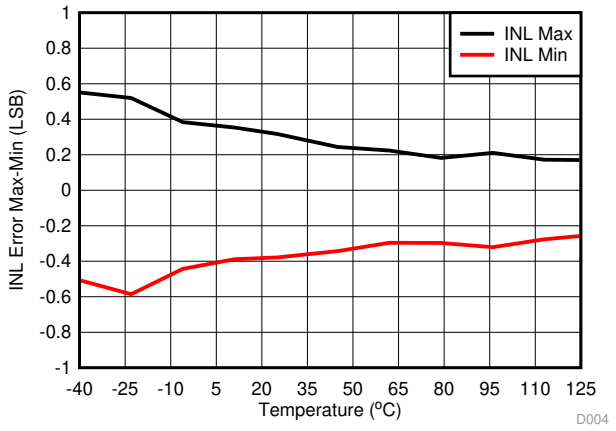


図 5. 積分直線性誤差と温度との関係

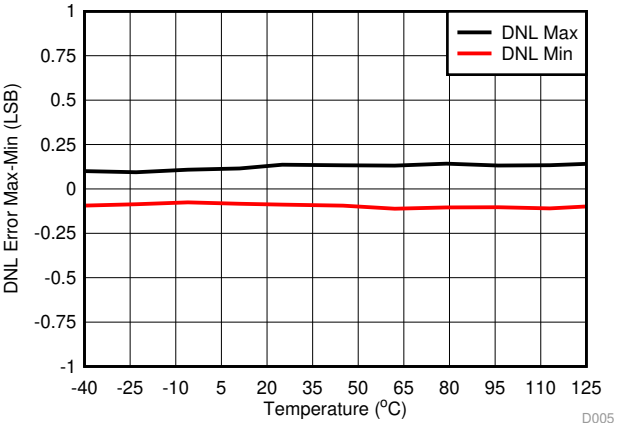


図 6. 微分直線性誤差と温度との関係

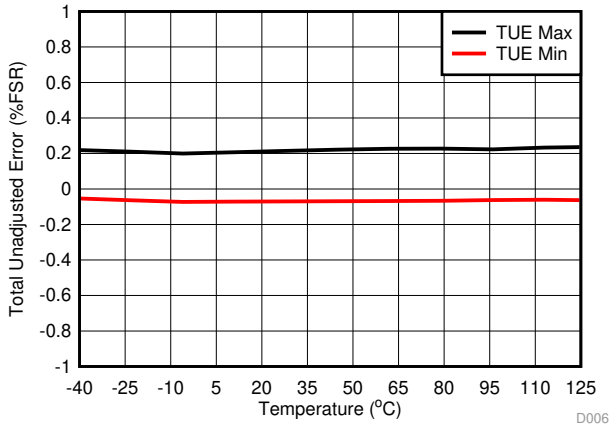


図 7. 総合未調整誤差と温度との関係

Copyright © 2018, Texas Instruments Incorporated

代表的特性：1.8V (continued)

T_A = 25°C、V_{DD} = 1.8V、リファレンス = 1.8V、DAC 出力は無負荷 (特に記述のない限り)

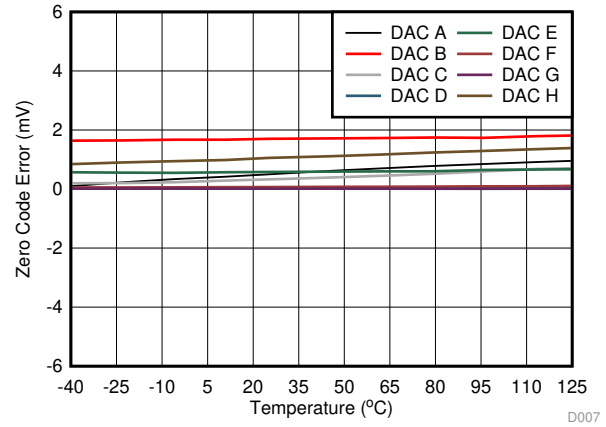


図 8. ゼロコード誤差と温度との関係

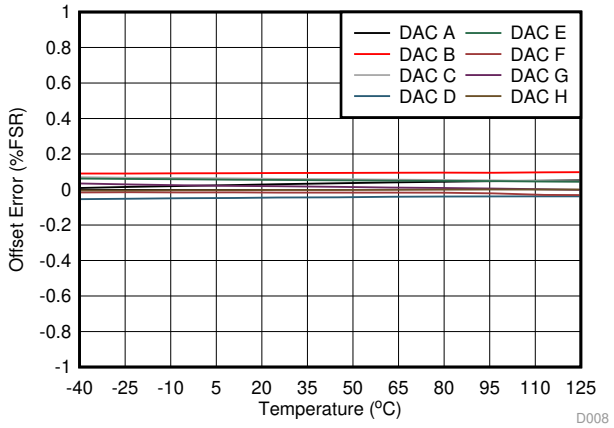


図 9. オフセット誤差と温度との関係

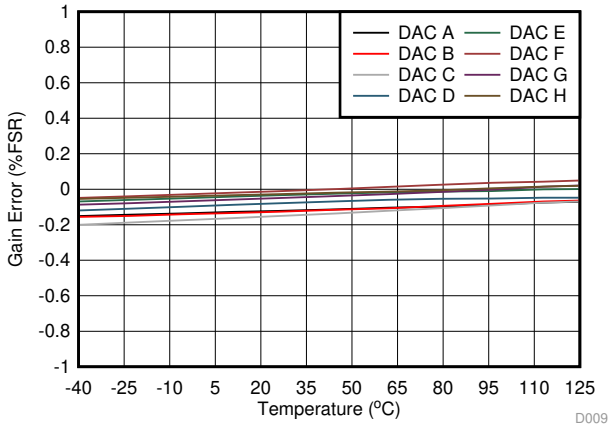


図 10. ゲイン誤差と温度との関係

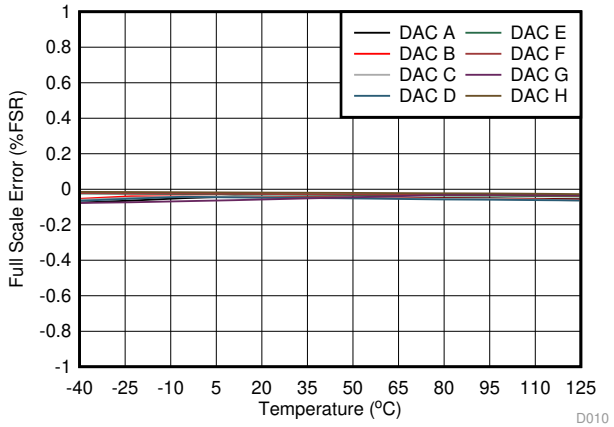


図 11. フルスケール誤差と温度との関係

Copyright © 2018, Texas Instruments Incorporated

7.11 代表的特性：5.5V

T_A = 25°C、V_{DD} = 5.5V、リファレンス = 5.5V、DAC 出力は無負荷 (特に記述のない限り)

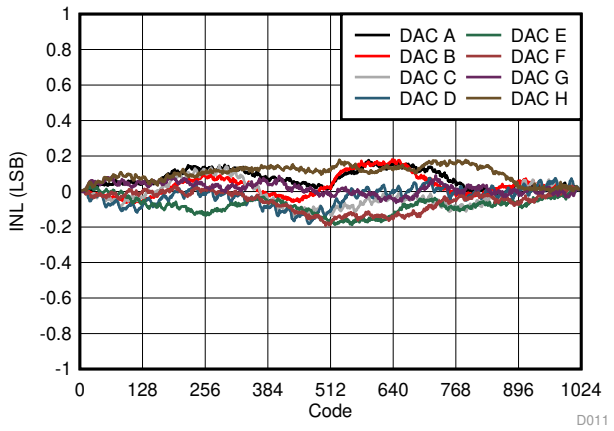


図 12. 積分直線性誤差とデジタル入力コードとの関係

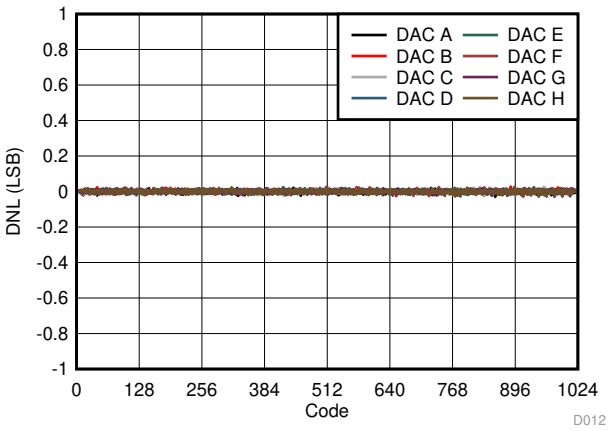


図 13. 微分直線性誤差とデジタル入力コードとの関係

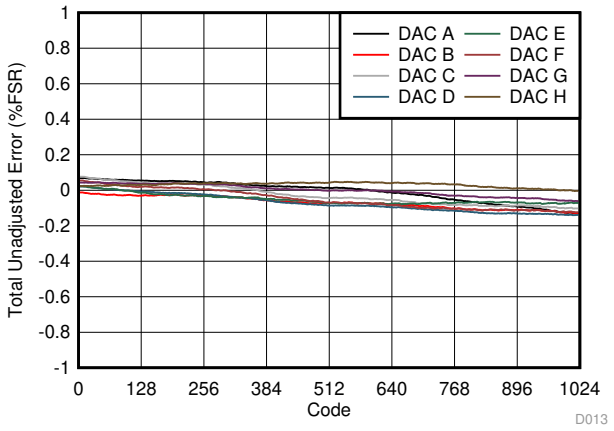


図 14. 総合未調整誤差とデジタル入力コードとの関係

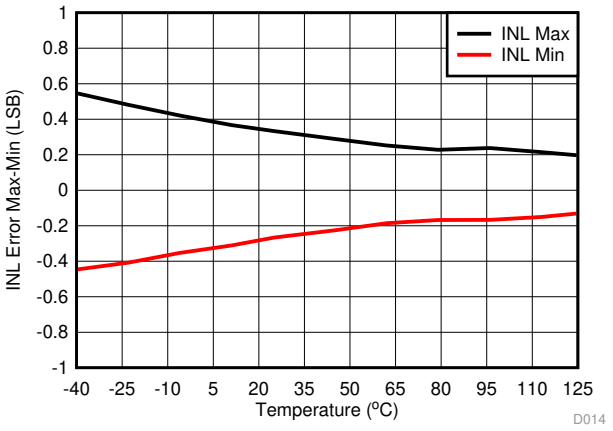


図 15. 積分直線性誤差と温度との関係

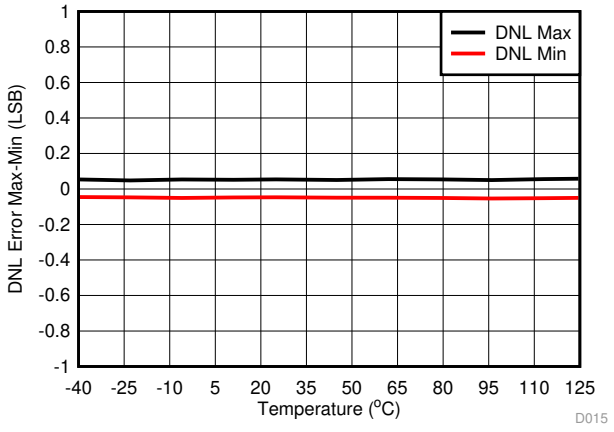


図 16. 微分直線性誤差と温度との関係

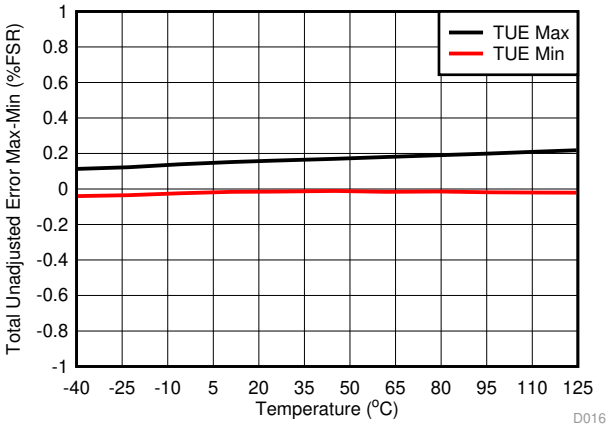


図 17. 総合未調整誤差と温度との関係

Copyright © 2018, Texas Instruments Incorporated

代表的特性：5.5V (continued)

T_A = 25°C、V_{DD} = 5.5V、リファレンス = 5.5V、DAC 出力は無負荷 (特に記述のない限り)

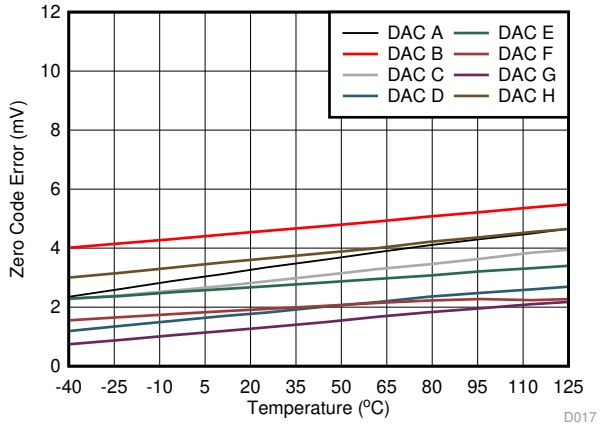


図 18. ゼロコード誤差と温度との関係

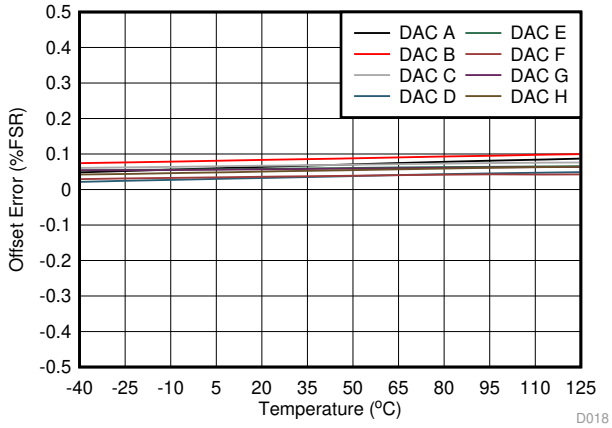


図 19. オフセット誤差と温度との関係

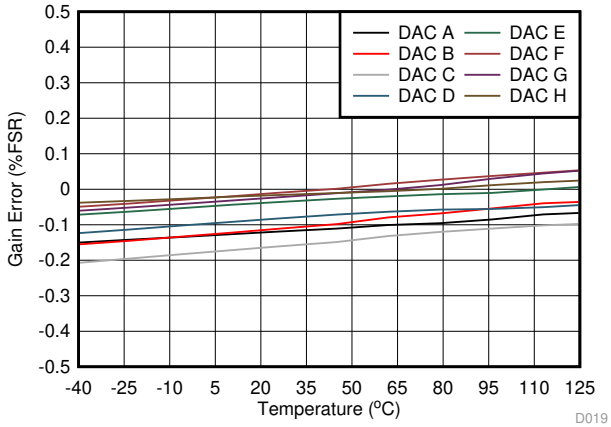


図 20. ゲイン誤差と温度との関係

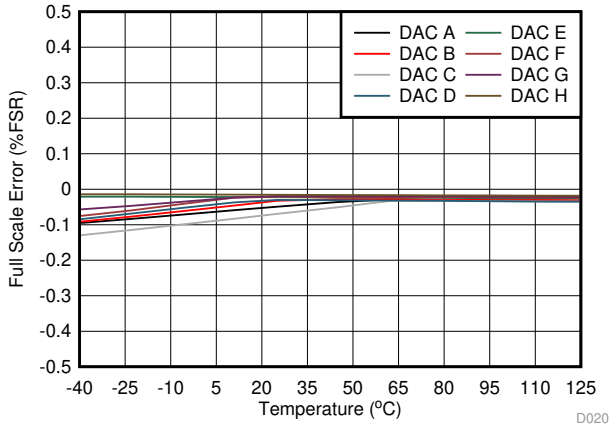


図 21. フルスケール誤差と温度との関係

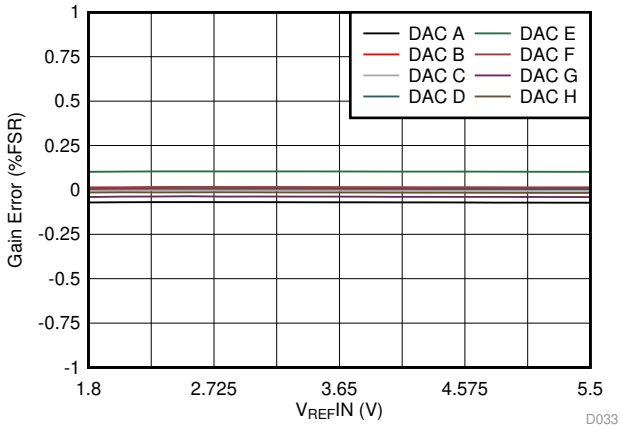


図 22. ゲイン誤差と基準電圧との関係

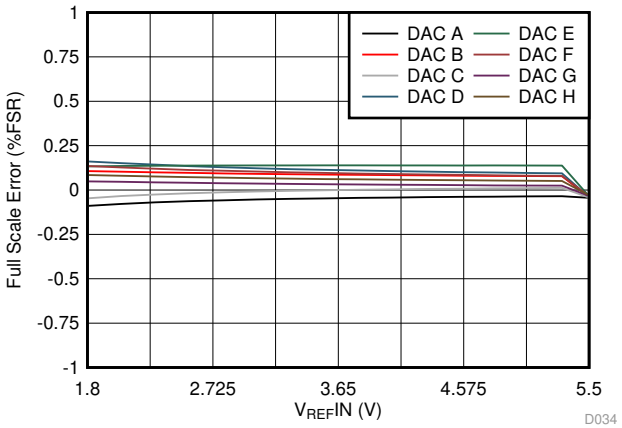
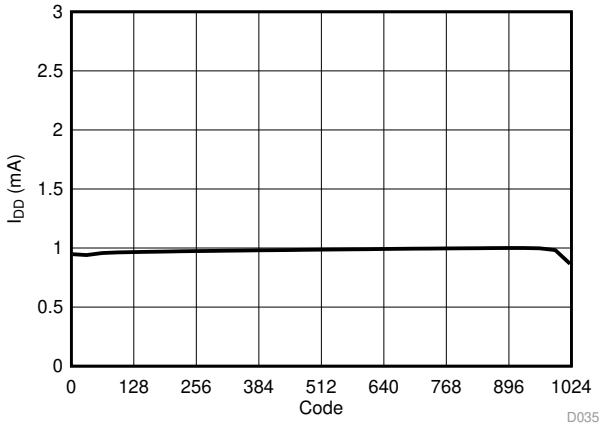


図 23. フルスケール誤差と基準電圧との関係

Copyright © 2018, Texas Instruments Incorporated

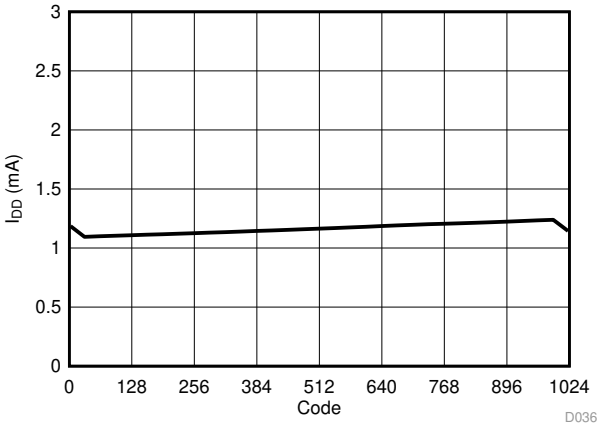
代表的特性：5.5V (continued)

T_A = 25°C、V_{DD} = 5.5V、リファレンス = 5.5V、DAC 出力は無負荷 (特に記述のない限り)



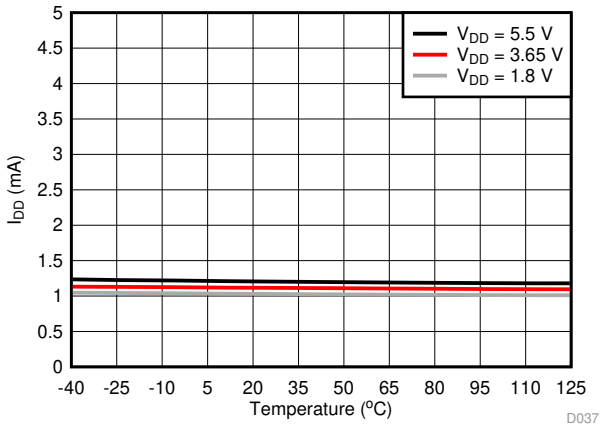
V_{DD} = 1.8V、リファレンス = 1.8V

図 24. 消費電流とデジタル入力コードとの関係



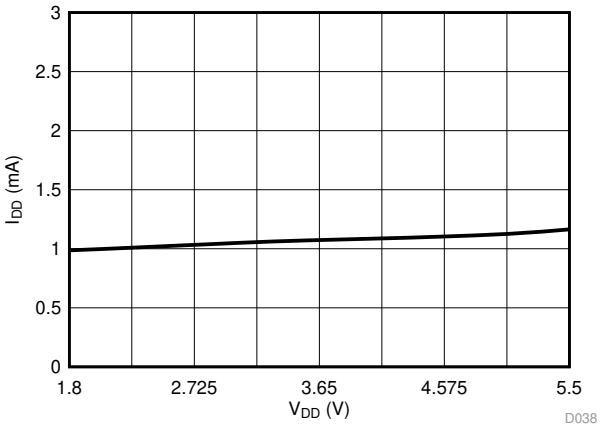
V_{DD} = 5.5V、リファレンス = 5.5V

図 25. 消費電流とデジタル入力コードとの関係



DAC コードはミッドスケール

図 26. 消費電流と温度との関係



DAC コードはミッドスケール、リファレンスを V_{DD} に接続

図 27. 消費電流と電源電圧との関係

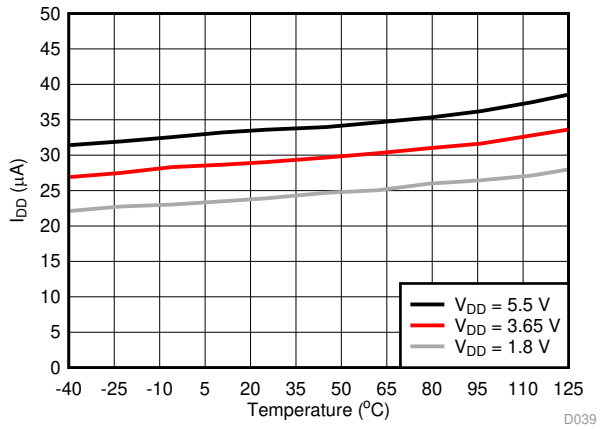
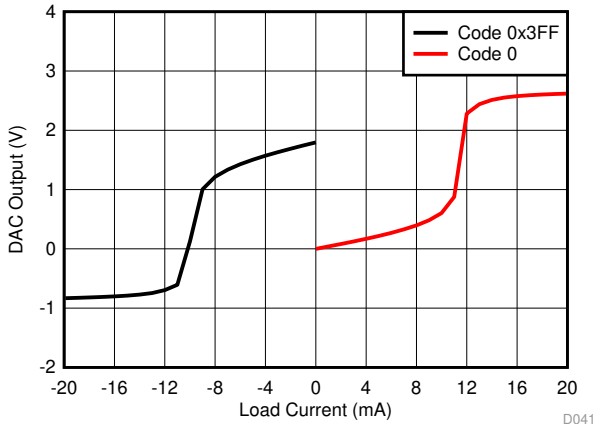


図 28. パワーダウン電流と温度との関係



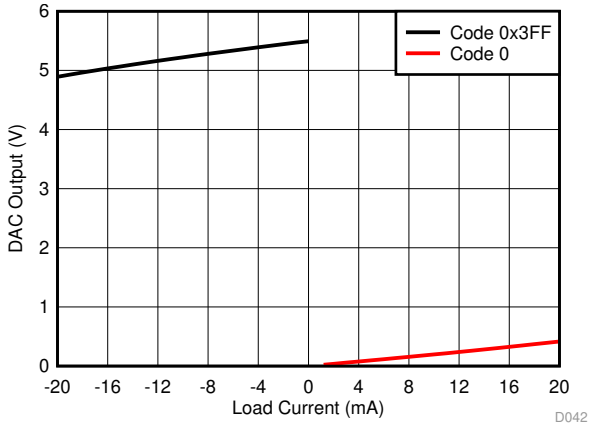
V_{DD} = 1.8V、リファレンス = 1.8V

図 29. ソース / シンク能力

Copyright © 2018, Texas Instruments Incorporated

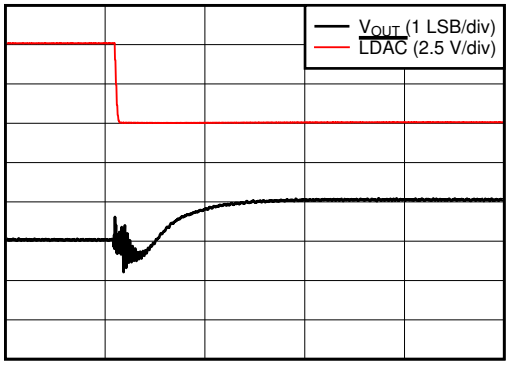
代表的特性：5.5V (continued)

T_A = 25°C、V_{DD} = 5.5V、リファレンス = 5.5V、DAC 出力は無負荷 (特に記述のない限り)



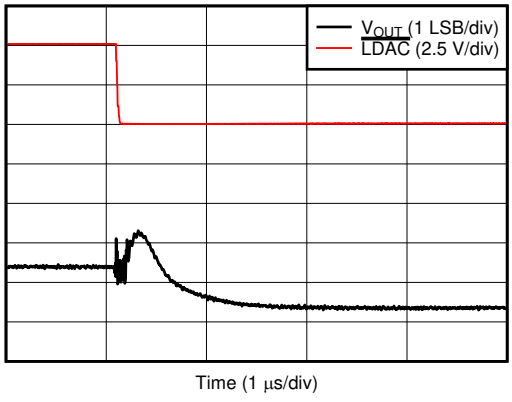
V_{DD} = 5.5V、リファレンス = 5.5V

図 30. ソース / シンク能力



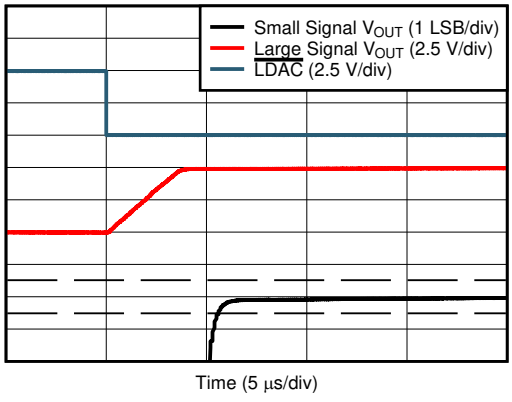
DAC コードはミッドスケール – 1LSB からミッドスケールへ遷移、DAC 出力負荷は 5kΩ//200pF

図 31. グリッチ・インパルス、立ち上がりエッジ、1LSB ステップ



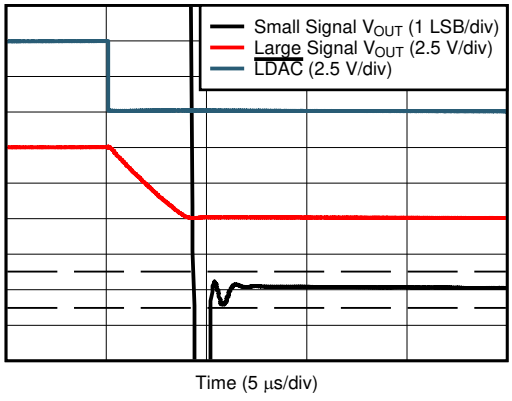
DAC コードはミッドスケールからミッドスケール – 1LSB へ遷移、DAC 出力負荷は 5kΩ//200pF

図 32. グリッチ・インパルス、立ち下がりエッジ、1LSB ステップ



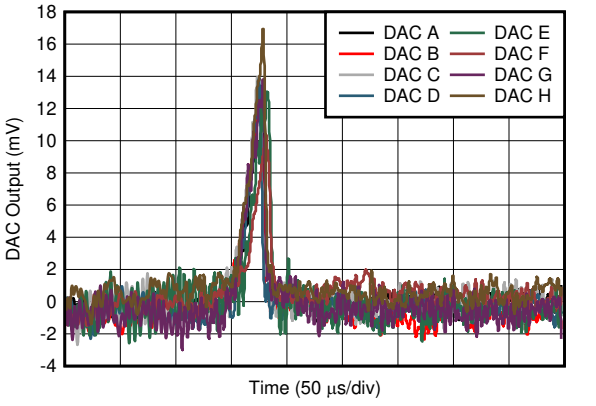
DAC コードは 102d から 922d へ遷移、代表的チャネルを表示、DAC 出力負荷は 5kΩ//200pF

図 33. フルスケール・セトリング時間、立ち上がりエッジ



DAC コードは 922d から 102d へ遷移、代表的チャネルを表示、DAC 出力負荷は 5kΩ//200pF

図 34. フルスケール・セトリング時間、立ち下がりエッジ

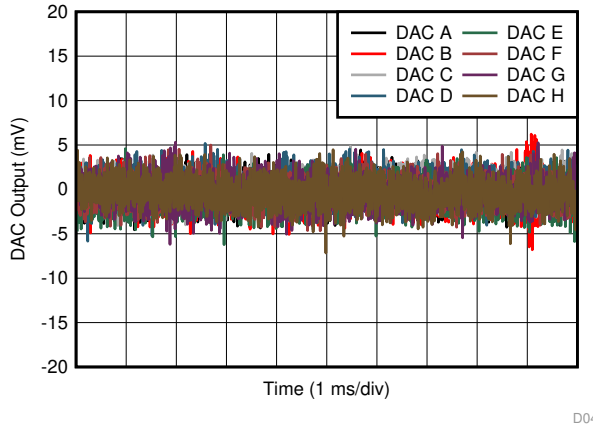


DAC 出力負荷は 5kΩ//200pF

図 35. 電源オン時のグリッチ

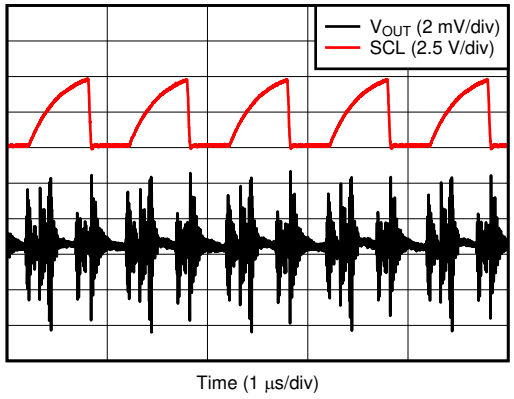
代表的特性：5.5V (continued)

T_A = 25°C、V_{DD} = 5.5V、リファレンス = 5.5V、DAC 出力は無負荷 (特に記述のない限り)



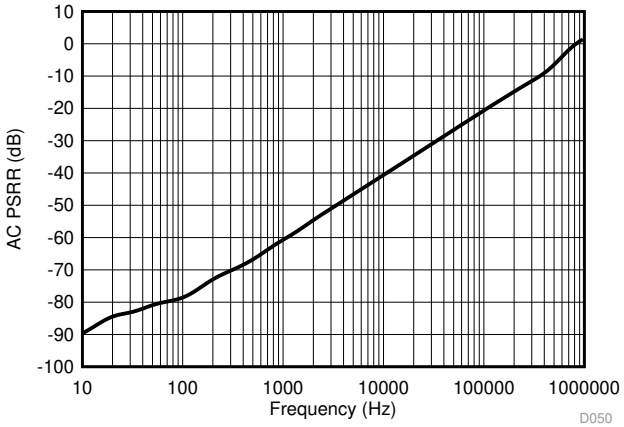
DAC 出力負荷は 5kΩ//200pF

図 36. 電源オフ時のグリッチ



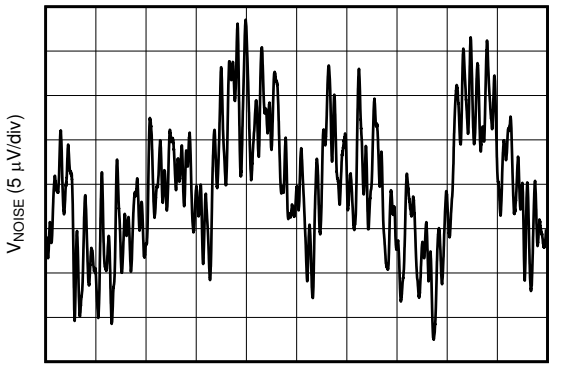
DAC コードはミッドスケール、リファレンスを V_{DD} に接続、出力負荷は 5kΩ//200pF

図 37. SCL = 1MHz でのクロック・フィードスルー



DAC コードはフルスケール、出力負荷は 5kΩ//200pF、V_{DD} = 5.25V + 0.2V_{PP}、V_{REF}IN = 4.5V

図 38. DAC 出力 AC PSRR と周波数との関係



DAC コードはミッドスケール

図 39. DAC 出力ノイズ 0.1Hz～10Hz

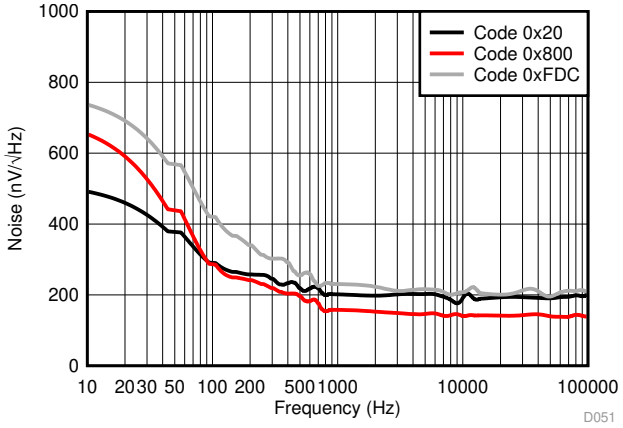


図 40. DAC出力ノイズ・スペクトル密度

Copyright © 2018, Texas Instruments Incorporated

7.12 代表的特性

T_A = 25°C、DAC 出力は無負荷 (特に記述のない限り)

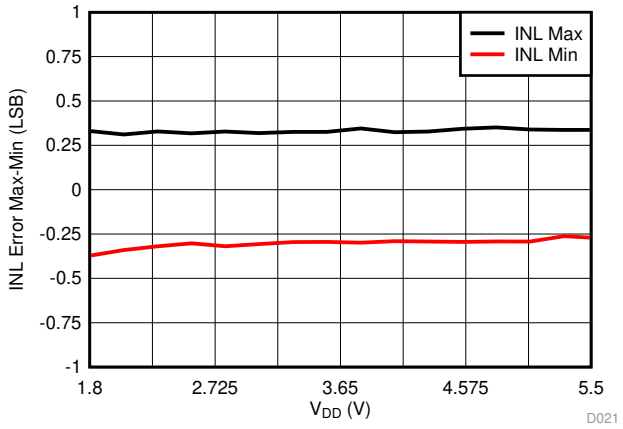


図 41. 積分直線性誤差と電源電圧との関係

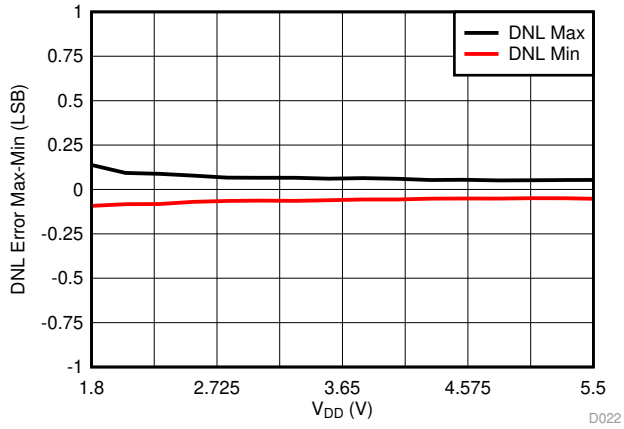


図 42. 微分直線性誤差と電源電圧との関係

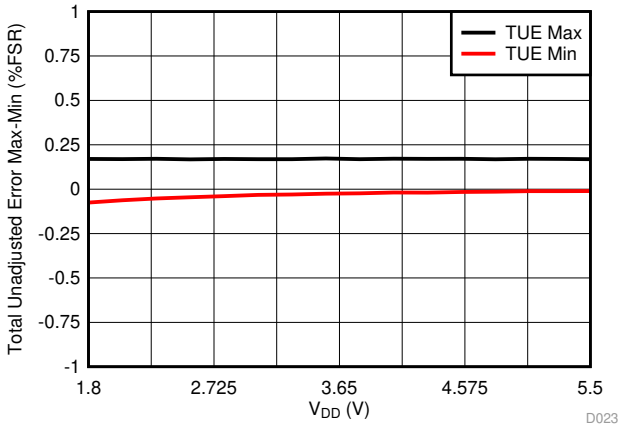


図 43. 総合未調整誤差と電源電圧との関係

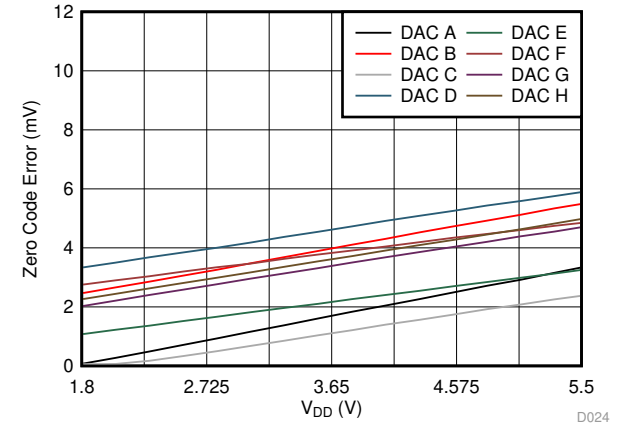


図 44. ゼロコード誤差と電源電圧との関係

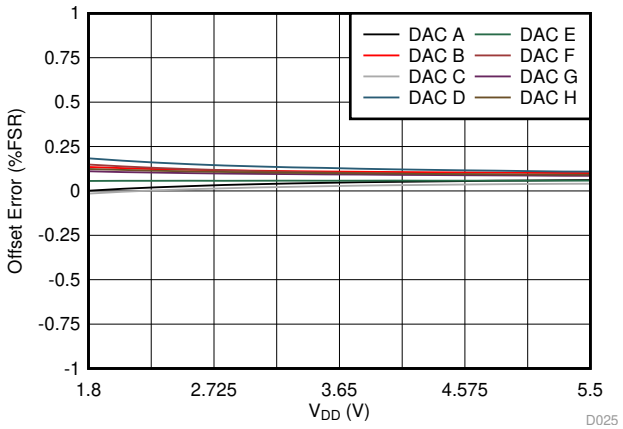


図 45. オフセット誤差と電源電圧との関係

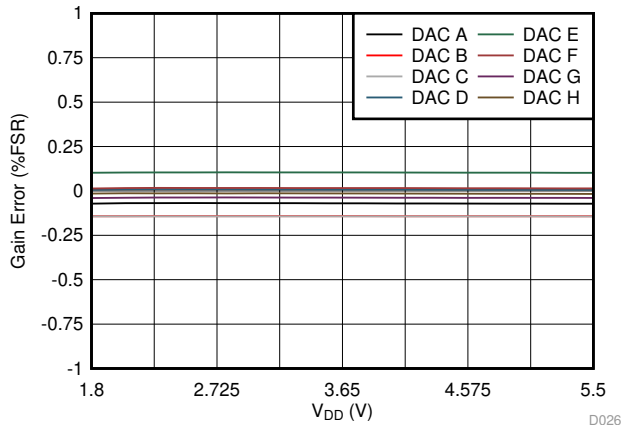


図 46. ゲイン誤差と電源電圧との関係

Copyright © 2018, Texas Instruments Incorporated

7.13 代表的特性

T_A = 25°C、V_{DD} = 5.5V、DAC 出力は無負荷 (特に記述のない限り)

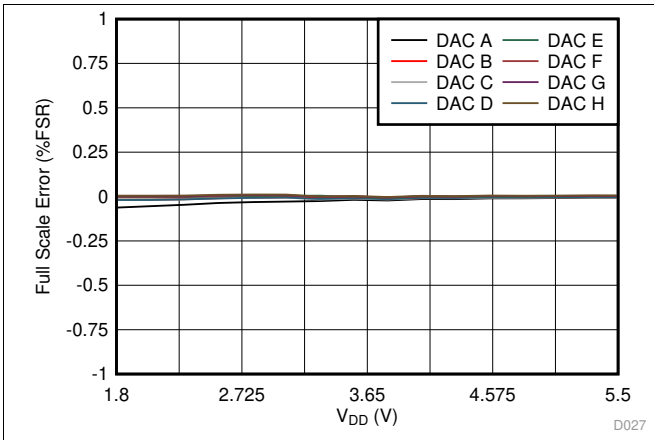


図 47. フルスケール誤差と電源電圧との関係

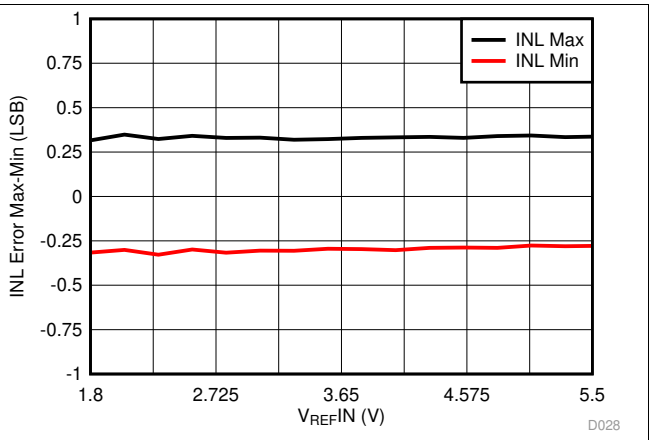


図 48. 積分直線性誤差と基準電圧との関係

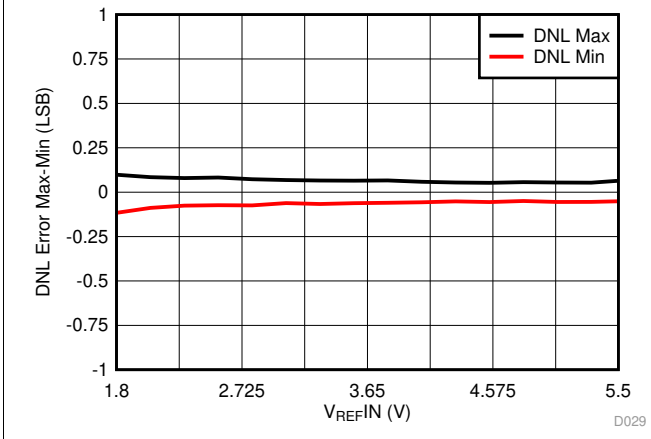


図 49. 微分直線性誤差と基準電圧との関係

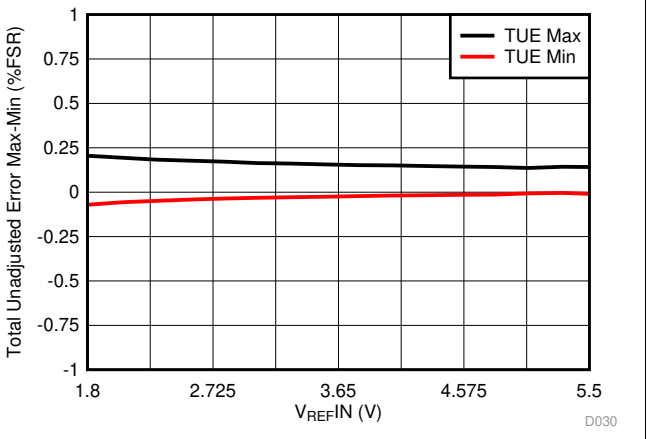


図 50. 総合未調整誤差と基準電圧との関係

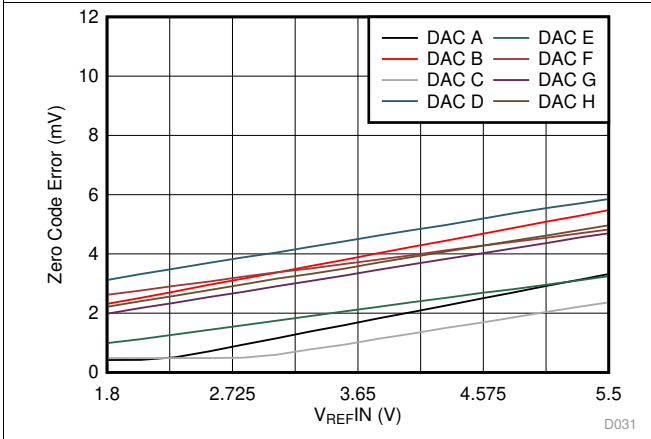


図 51. ゼロコード誤差と基準電圧との関係

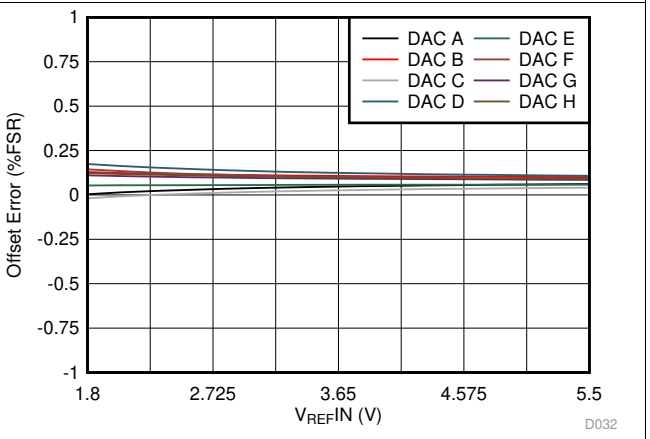


図 52. オフセット誤差と基準電圧との関係

Copyright © 2018, Texas Instruments Incorporated

8 詳細説明

8.1 概要

DAC53608 と DAC43608 は、10 ビットおよび 8 ビットの分解能を持つ 8 チャネル・バッファ付き電圧出力デジタル / アナログ・コンバータ (DAC) のピン互換ファミリです。1.8V～5.5V の外部リファレンスにより、1.8V～5.5V のフルスケール電圧を出力できます。全電源電圧範囲にわたって単調性を維持します。

デバイスとの通信は I^2C^{TM} 互換インターフェイスで行い、I^2C^{TM} の Standard モード (100kbps)、Fast モード (400kbps)、Fast+ モード (1Mbps) をサポートしています。また、DAC を同時に更新できるロード DAC ($\overline{LDAC}$) ピンも備えています。

DACx3608 は -40°C～+125°Cの温度範囲で仕様が規定されており、小型の QFN パッケージで供給されます。

8.2 機能ブロック図

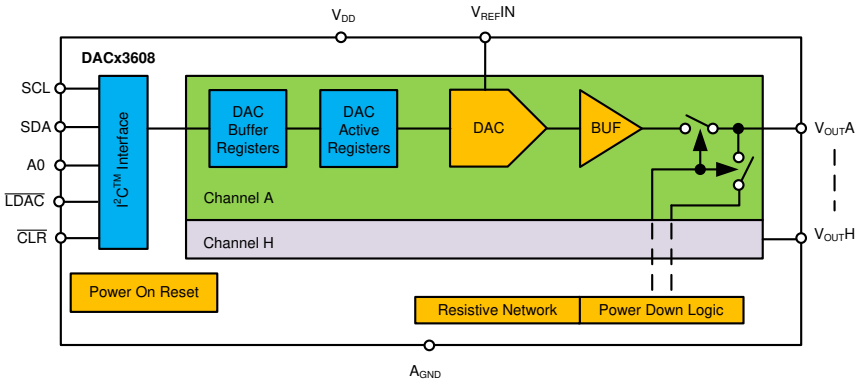


図 53. DACx3608 DAC のブロック図

8.3 機能説明

8.3.1 デジタル / アナログ・コンバータ (DAC) アーキテクチャ

DACx3608 ファミリの各出力チャネルは、ストリング・アーキテクチャと出力バッファ・アンプで構成されています。図 54 に DAC アーキテクチャのブロック図を示します。

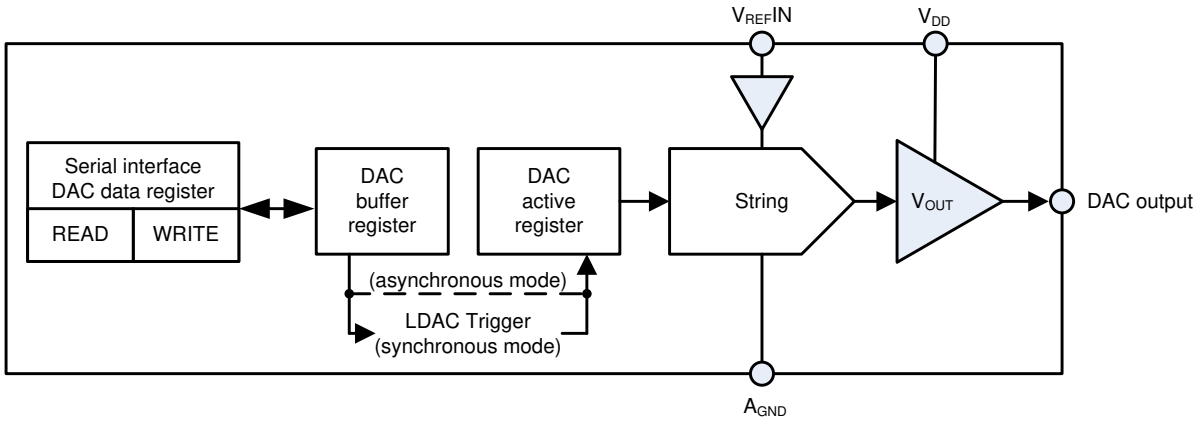


図 54. DACx3608 DAC のアーキテクチャ

8.3.1.1 DAC の伝達関数

個々の DAC データ・レジスタに対する入力データは、ストレート・バイナリ形式で記述します。電源オンまたはリセット・イベント後に、すべての DAC レジスタはゼロコードに設定されます。式 1 に DAC 伝達関数を示します。

$$V_{OUT}X = \frac{DACn_DATA}{2^N} \times V_{REF}IN$$

ここで

- N = 分解能 (ビット)
  - 10 (DAC53608) と 8 (DAC43608) のどちらか
- DACn_DATA は DAC レジスタにロードされるバイナリ・コードに等価な 10 進数です。
- DACn_DATA の範囲は 0～2^N – 1 です。
- V_{REF}IN は DAC の基準電圧です。 (1)

8.3.1.2 DAC レジスタの更新と $\overline{LDAC}$ 機能

DAC データ・レジスタに書き込まれたデータは DAC バッファ・レジスタに保存されます。DAC バッファ・レジスタから DAC アクティブ・レジスタへのデータ転送は、即実行 (非同期モード) か $\overline{LDAC}$ トリガにより開始 (同期モード) のどちらかに設定できます。DAC アクティブ・レジスタが更新されると、DAC 出力は新しい値に変わります。

各 DAC チャネルの更新モードは、$\overline{LDAC}$ ピンの状態によって決まります。

非同期モード (DAC 書き込みコマンドより前に $\overline{LDAC}$ = 0) では、DAC データ・レジスタに書き込みを行うと、I^2C^{TM} フレームが終了した時点で DAC アクティブ・レジスタと DAC 出力が即更新されます。

同期モード (DAC 書き込みコマンドより前に $\overline{LDAC}$ = 1) では、DAC データ・レジスタに書き込みを行っても DAC 出力は自動的に更新されず、$\overline{LDAC}$ が 0 になって初めて更新が実行されます。同期更新モードでは、すべての DAC 出力を同時に更新できます。

8.3.1.3 $\overline{CLR}$ 機能

$\overline{CLR}$ ピンは DAC への非同期入力ピンです。このピンが Low になると (論理 0)、DAC バッファおよび DAC アクティブ・レジスタはゼロコードになります。

Copyright © 2018, Texas Instruments Incorporated

機能説明 (continued)

8.3.1.4 出力アンプ

出力バッファ・アンプは、出力上に 0V～V_{DD} の最大出力範囲でレール・ツー・レール電圧を生成します。式 1 は DAC 出力のフルスケール出力範囲が V_{REF}IN ピンの電圧によって決まることを示しています。

8.3.2 リファレンス

DACx3608 は、外部リファレンスを使用する必要があります。ただし、リファレンス・ピン V_{REF}IN と電源ピン V_{DD} は互いに接続できます。リファレンス入力ピンの電圧範囲は 1.8V～V_{DD} です。全チャネルがオンになっている場合、このピンの標準的な入力インピーダンスは 12.5kΩ です。

8.3.3 パワーオン・リセット (POR)

DACx3608 ファミリは、電源投入時に出力電圧を制御するパワーオン・リセット (POR) 機能を備えています。V_{DD} 電源が立ち上がると、POR イベントが発行されます。POR により、全レジスタはデフォルト値に初期化され、V_{DD} が DAC の動作電圧範囲に達した後 5ms 経過してから通信が有効になります。DAC データ・レジスタのデフォルト値はゼロコードです。DAC の出力は、有効なコマンドがチャネルに書き込まれるまで、電源投入時の電圧のままです。

電源投入時に、POR 回路によりデバイスがデフォルト値に設定されます。電源投入時に内部コンデンサが放電しデバイスをリセットすることを確実にするには、図 55 に示す特定の V_{DD} レベルが POR 回路に必要です。POR を確実に実行するには、V_{DD} が 0.7V 未満の状態を 1ms 以上継続する必要があります。V_{DD} が 1.7V 未満に降下しても 0.7V を上回っている場合 (未定義領域として表示)、温度および電源のすべての規定条件でリセットするかどうかは分かりません。この場合、POR を起動します。V_{DD} が 1.7V を上回ったままであれば、POR は実行されません。

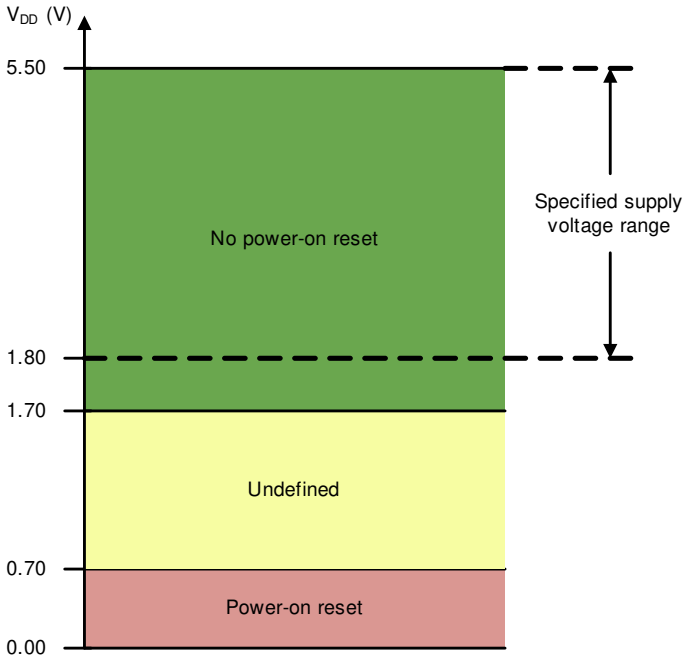


図 55. V_{DD} POR 回路のスレッショルド・レベル

8.3.4 ソフトウェア・リセット

ソフトウェア・リセット・イベントは、TRIGGER レジスタ (アドレス 2h) の SW-RST ビットに予約コード 0x1010 を書き込むことにより起動します。

8.4 デバイスの機能モード

DACx3608 には、通常モードとパワーダウン・モードという 2 つの動作モードがあります。

Copyright © 2018, Texas Instruments Incorporated

デバイスの機能モード (continued)

8.4.1 パワーダウン・モード

DACx3608 DAC 出力アンプは、DEVICE_CONFIG レジスタを介して、個別またはグローバルにパワーダウンできます (A_{GND} に対して 10K)。この状態で、本デバイスは 50µA (V_{DD} = 1.8V) を消費します。全出力チャネルのバッファ・アンプが 10K モードにパワーダウンした状態で起動し、チャネルごとのパワーダウン・レジスタに 0 が書き込まれパワーアップ・コマンドが発行されるまでその状態を維持します。

8.5 プログラミング

ピン構成および機能 に示すように、DACx3608 は 2 線式シリアル・インターフェイスとして SCL、SDA、1 つのアドレス・ピン A0 を備えています。 I^2C^{TM} バスは、プルアップ構造を持つデータ・ライン（SDA）とクロック・ライン（SCL）で構成されます。バスがアイドルのときは、SDA と SCL の両方が High になります。I^2C^{TM} 互換のデバイスはすべて、オープン・ドレインの I/O ピンである SDA および SCL を介して I^2C^{TM} バスに接続します。

I^2C^{TM} 仕様では、通信を制御するデバイスをマスタといい、マスタに制御されるデバイスをスレーブといいます。マスタ・デバイスは SCL 信号を生成します。また、専用のタイミング条件 (スタート条件、再スタート条件、ストップ条件) をバスに生成して、データ転送の開始または停止を通知します。デバイス・アドレッシングはマスタが実行します。I^2C^{TM} バス上のマスタ・デバイスは通常、マイクロコントローラまたはデジタル・シグナル・プロセッサ (DSP) です。DACx3608 ファミリは、I^2C^{TM} バス上でスレーブ・デバイスとして動作します。スレーブ・デバイスはマスタのコマンドに対して確認応答し、マスタの制御に従ってデータを送受信します。

通常、DACx3608 ファミリはスレーブ・レシーバとして動作します。マスタ・デバイスは、スレーブ・レシーバである DACx3608 に対して書き込みを行います。ただし、マスタ・デバイスが DACx3608 の内部レジスタ・データを必要とする場合は、DACx3608 ファミリがスレーブ・トランスミッタとして動作します。この場合、マスタ・デバイスは DACx3608 から読み取ります。I^2C^{TM} の用語では、読み取り / 書き込みといえばマスタ・デバイスを指します。

DACx3608 ファミリはスレーブであり、次のデータ転送モードをサポートしています。

- Standard モード (100kbps)
- Fast モード (400kbps)
- Fast+ モード (1.0Mbps)

Standard モードと Fast モードのデータ転送プロトコルはまったく同じであるため、このデータシートではこれらのモードを F/S モードと呼びます。Fast+ モードのプロトコルについては、データ転送速度はサポートしていますが、出力電流はサポートしていません。低レベル出力電流は、Standard モードおよび Fast モードの場合と同様に 3mA となります。DACx3608 ファミリは 7 ビット・アドレッシングをサポートしています。10 ビット・アドレッシング・モードはサポートしていません。また、ジェネラル・コール・リセット機能をサポートしています。次のシーケンスを送信すると、デバイス内でソフトウェア・リセットが起動します。スタート / 再スタート、0x00、0x06、ストップ。2 番目のバイトに続く、ACK ビットの立ち上がりエッジで、リセットがデバイス内でアサートされます。

指定のタイミング信号を除いて、I^2C^{TM} インターフェイスではシリアル・バイトを扱います。各バイトの最後に、9 回目のクロック・サイクルで確認応答信号が生成および検出されます。確認応答は、9 回目のクロック・サイクルの High 期間中 SDA ラインを Low にすることで行われます。否定応答は、図 56 に示すように 9 回目のクロック・サイクルの High 期間中 SDA ラインを High のまま保持することで行われます。

Copyright © 2018, Texas Instruments Incorporated

プログラミング (continued)

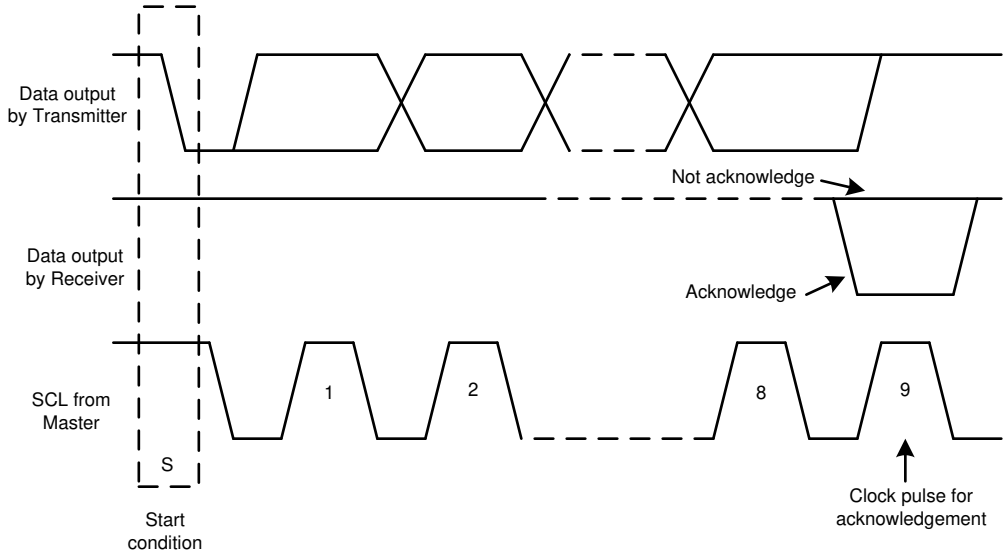


図 56. I²C™ バスの確認応答と否定応答

8.5.1 F/S モードのプロトコル

1. マスタがスタート条件を生成して、データ転送を開始します。スタート条件は、図 57 に示すように SCL が High の間に SDA ラインが High から Low に遷移すると発生します。すべての I²C™ 互換デバイスが、スタート条件を認識します。

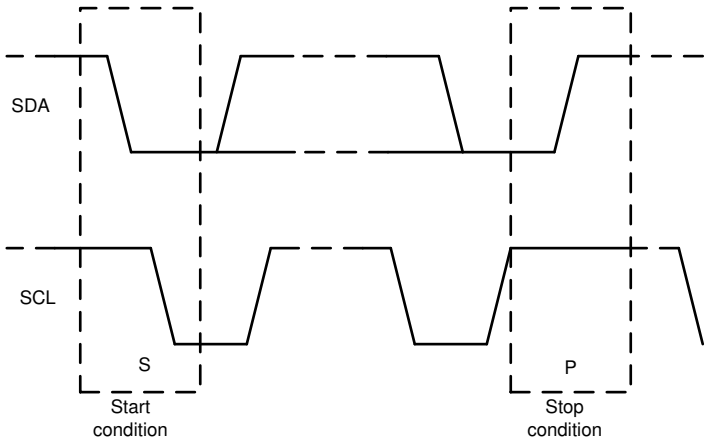


図 57. スタート条件とストップ条件

プログラミング (continued)

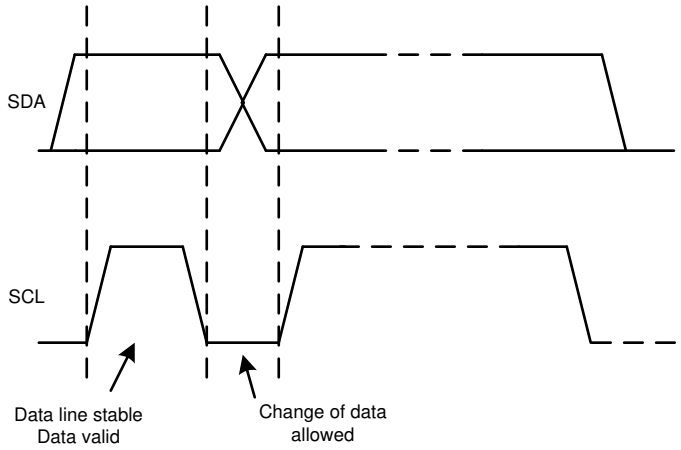


図 58. I²C™ バスでのビット転送

2. 次に、マスタは SCL パルスを生成し、7 ビットのアドレスと読み取り / 書き込み方向ビット (R/W) を SDA ライン上で送信します。すべての送信中、データが有効であることをマスタは確認します。図 58 に示すように、データが有効であるためには、クロック・パルスの High 期間全体にわたって SDA ラインが安定している必要があります。すべてのデバイスは、マスタによって送信されたアドレスを認識して、デバイス内部の固定アドレスと比較します。図 56 に示すように、一致するアドレスを持つスレーブ・デバイスだけが、9 回目の SCL サイクルの High 期間全体の間 SDA ラインを Low にすることで、確認応答を生成します。この確認応答を検出することで、マスタはスレーブとの通信リンクが確立されたことを認識します。
3. マスタは、スレーブへのデータ送信 (R/W ビット 0) またはスレーブからのデータ受信 (R/W ビット 1) を行うために、引き続き SCL サイクルを生成します。どちらの場合も、送信側から送信されたデータに対して受信側が確認応答を返す必要があります。したがって、確認応答信号は、どちらが受信側かによって、マスタが生成する場合とスレーブが生成する場合があります。8 ビットのデータと 1 ビットの確認応答で構成される 9 ビットの有効なデータ・シーケンスを、必要な長さだけ続けることができます。
4. データ転送の終わりを通知するときには、マスタは SCL ラインが High の間に SDA ラインを Low から High にすることで、ストップ条件を生成します (図 57 を参照)。これによってバスが解放され、アドレス指定されたスレーブとの通信リンクが停止します。すべての I²C™ 互換デバイスが、ストップ条件を認識します。ストップ条件の受信によって、バスは解放され、すべてのスレーブ・デバイスはスタート条件および一致するアドレスが送信されるのを待ちます。

Copyright © 2018, Texas Instruments Incorporated

プログラミング (continued)

8.5.2 DACx3608 の I²C™ 更新シーケンス

表 1 に示すように DACx3608 では、1 回の更新のために、スタート条件、有効な I²C™ アドレス・バイト、コマンド・バイト、2 つのデータ・バイト (最上位データ・バイト (MSDB) と最下位データ・バイト (LSDB)) を必要とします。

表 1. 更新シーケンス

MSB	....	LSB	ACK	MSB	...	LSB	ACK	MSB	...	LSB	ACK	MSB	...	LSB	ACK
アドレス (A) バイト				コマンド・バイト				MSDB				LSDB			
DB [32:24]				DB [23:16]				DB [15:8]				DB [7:0]			

図 59 に示すように、各バイトの受信後、DACx3608 ファミリは 1 つのクロック・パルスの High 期間中に SDA ラインを Low にすることで、確認応答を行います。この 4 つのバイトと確認応答サイクルにより、1 回の更新を実行するために必要な 36 のクロック・サイクルが生成されます。有効な I²C™ アドレス・バイトによって、DACx3608 が選択されます。

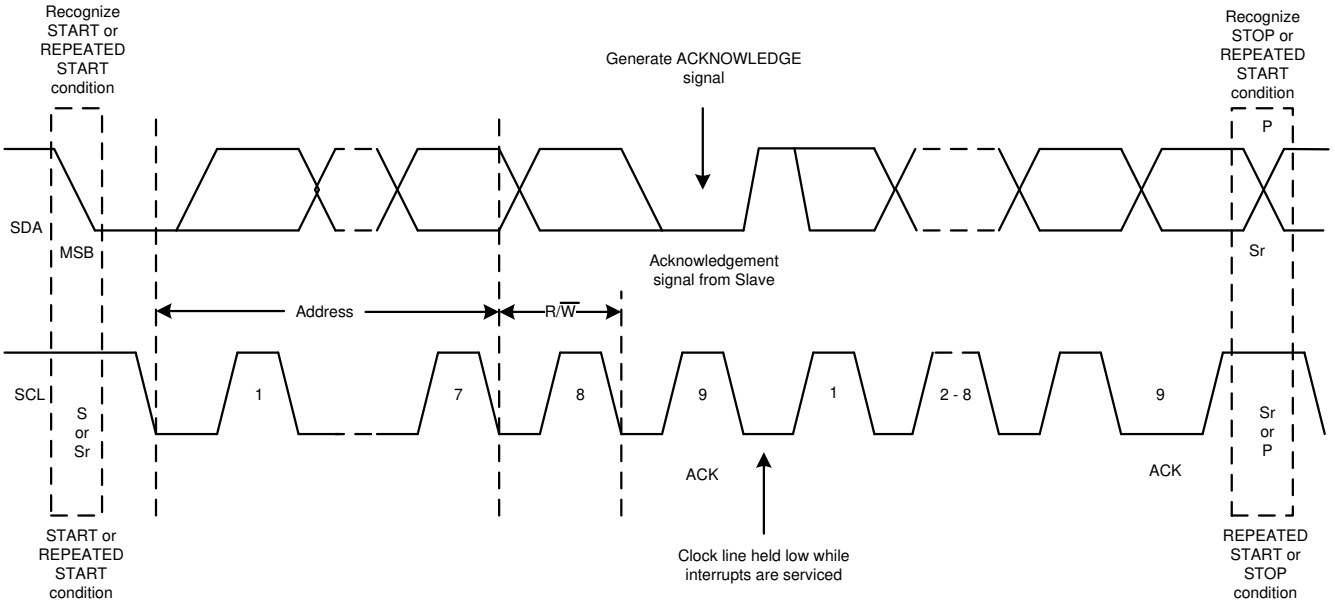


図 59. I²C™ バス・プロトコル

コマンド・バイトは、選択された DACx3608 の動作モードを設定します。このバイトによって動作モードが選択されると、DACx3608 シリーズは、データ更新を実行するために、最上位データ・バイト (MSDB) と最下位データ・バイト (LSDB) という 2 つのデータ・バイトを受信する必要があります。DACx3608 は、LSDB に続く確認応答信号の立ち下がりエッジで更新を実行します。

Fast モード (クロック = 400kHz) を使用すると、最大 DAC 更新レートは 22.22kSPS となります。Fast+ モード (クロック = 1MHz) を使用すると、最大 DAC 更新レートは 55.55kSPS となります。ストップ条件を受信すると、DACx3608 ファミリは I²C™ バスを解放し、新たなスタート条件を待ちます。

8.5.3 DACx3608 のアドレス・バイト

表 2 に示すアドレス・バイトは、マスタ・デバイスからスタート条件に続いて受信する最初のバイトです。アドレスの最初の 4 ビット (MSB) は工場出荷時に 1001 に設定されます。次の 3 ビットは A0 ピンによって制御されます。A0 ピンの入力は V_{DD}、A_{GND}、SCL、または SDA に接続できます。各データ・フレームの最初のバイトにおいて A0 ピンがサンプリングされて、アドレスが決定します。デバイスはアドレス・ピンの値をラッチし、その結果として、表 3 に従ってその特定のアドレスに応答します。

DACx3608 ファミリはブロードキャスト・アドレッシングをサポートしています。ブロードキャスト・アドレッシングは、複数の DACx3608 の同期更新やパワーダウンに使用できます。DACx3608 ファミリのデバイスは、互いに組み合わせて使うことでマルチチップ同期更新をサポートするように設計されています。ブロードキャスト・アドレスを使用して、アドレス・ピンの状態に関係なく応答します。ブロードキャストは書き込みモードでのみサポートしています。

Copyright © 2018, Texas Instruments Incorporated

表 2. DACx3608 のアドレス・バイト

備考	MSB							LSB
	AD6	AD5	AD4	AD3	AD2	AD1	AD0	R/$\overline{W}$
ジェネラル・アドレス	1	0	0	1	表 3 (スレーブ・アドレスの列) を参照			0 または 1
ブロードキャスト・アドレス	1	0	0	0	1	1	1	0

表 3. アドレス形式

スレーブ・アドレス	**A0** ピン
1001 000	A_{GND}
1001 001	V_{DD}
1001 010	SDA
1001 011	SCL

Copyright © 2018, Texas Instruments Incorporated

8.5.4 DACx3608 のコマンド・バイト

DACx3608 のコマンド・バイト (表 4 参照) は、DACx3608 シリーズに対して書き込みや読み取りを行うとき、実行するコマンドとアクセスするレジスタを制御します。

表 4. DACx3608 のコマンド・バイト

B23	B22	B21	B20	B19	B18	B17	B16	備考
0	0	0	0	0	0	0	1	DEVICE_CONFIG
0	0	0	0	0	0	1	0	STATUS/TRIGGER
0	0	0	0	0	0	1	1	BRDCAST
0	0	0	0	1	0	0	0	DACA_DATA
0	0	0	0	1	0	0	1	DACB_DATA
0	0	0	0	1	0	1	0	DACC_DATA
0	0	0	0	1	0	1	1	DACD_DATA
0	0	0	0	1	1	0	0	DACE_DATA
0	0	0	0	1	1	0	1	DACF_DATA
0	0	0	0	1	1	1	0	DACG_DATA
0	0	0	0	1	1	1	1	DACH_DATA

8.5.5 DACx3608 のデータ・バイト (MSDB と LSDB)

表 5 に示すように、MSDB と LSDB には、コマンド・バイトで指定されるレジスタに渡されるデータが含まれています。DACx3608 ファミリは、LSDB[0] ビットに続く確認応答信号の立ち下がりエッジで更新を実行します。

表 5. DACx3608 のデータ・バイト

コマンド・ビット	データ・ビット												
	MSDB				LSDB								
B19 - B16	B15 - B12	B11	B10	B9	B8	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
DEVICE_CONFIG	x	0	0	0	PDN-All	PDNH	PDNG	PDNF	PDNE	PDND	PDNC	PDNB	PDNA
STATUS/TRIGGER	x	DEVICE_ID						x	x	SW_RST			
BRDCAST	x	BRDCAST_DATA[9:0] / BRDCAST_DATA[7:0] – MSB 左揃え										x	x
DACA_DATA	x	DACA_DATA[9:0] / DACA_DATA[7:0] – MSB 左揃え										x	x
DACB_DATA	x	DACB_DATA[9:0] / DACB_DATA[7:0] – MSB 左揃え										x	x
DACC_DATA	x	DACC_DATA[9:0] / DACC_DATA[7:0] – MSB 左揃え										x	x
DACD_DATA	x	DACD_DATA[9:0] / DACD_DATA[7:0] – MSB 左揃え										x	x
DACE_DATA	x	DACE_DATA[9:0] / DACE_DATA[7:0] – MSB 左揃え										x	x
DACF_DATA	x	DACF_DATA[9:0] / DACF_DATA[7:0] – MSB 左揃え										x	x
DACG_DATA	x	DACG_DATA[9:0] / DACG_DATA[7:0] – MSB 左揃え										x	x
DACH_DATA	x	DACH_DATA[9:0] / DACAH_DATA[7:0] – MSB 左揃え										x	x

8.5.6 DACx3608 の I^2C^{TM} 読み取りシーケンス

レジスタを読み取るには、次のコマンド・シーケンスを使用する必要があります。

1. スタートまたは再スタート・コマンドとスレーブ・アドレス、書き込みの 0 に設定した R/$\overline{W}$ ビットを送信します。デバイスがこのイベントに対して確認応答します。
2. 読み取り対象レジスタのコマンド・バイトを送信します。デバイスがこのイベントに対して再度、確認応答します。
3. 再スタートとスレーブ・アドレス、読み取りの「1」に設定した R/$\overline{W}$ ビットを送信します。デバイスがこのイベントに対して確認応答します。
4. デバイスがアドレス指定されたレジスタの MSDB バイトを書き込みます。マスタはこのバイトに対して確認応答する必要があります。
5. 最後に、デバイスがレジスタの LSDB を書き出します。

Copyright © 2018, Texas Instruments Incorporated

別の読み取り方法として、書き込まれた最後のレジスタの値を読み返すこともできます。このシーケンスでは、スタートまたは再スタートとスレーブ・アドレス、1 に設定した R/$\overline{W}$ ビットを送信することで、最後のレジスタの 2 バイトが読み出されます。DACx3608 ファミリのレジスタは、SW-RST レジスタ以外はすべて読み取り可能です。表 5 に読み取りコマンド・セットを示します。

なお、読み取りではブロードキャスト・アドレスを使用できません。

表 6. 読み取りシーケンス

S	MSB	…	R/$\overline{W}$ (0)	ACK	MSB	…	LSB	ACK	Sr	MSB	…	R/$\overline{W}$ (1)	ACK	MSB	…	LSB	ACK	MSB	…	LSB	ACK
	ADDRESS BYTE				COMMAND BYTE				Sr	ADDRESS BYTE				MSDB				LSDB			
マスタから				スレーブ	マスタから			スレーブ	マスタから				スレーブ	スレーブから			マスタ	スレーブから			マスタ

8.6 レジスタ・マップ

Table 7. レジスタ・アドレス

B23	B22	B21	B20	B19	B18	B17	B16	備考
0	0	0	0	0	0	0	1	DEVICE_CONFIG
0	0	0	0	0	0	1	0	STATUS/TRIGGER
0	0	0	0	0	0	1	1	BRDCAST
0	0	0	0	1	0	0	0	DACA_DATA
0	0	0	0	1	0	0	1	DACB_DATA
0	0	0	0	1	0	1	0	DACC_DATA
0	0	0	0	1	0	1	1	DACD_DATA
0	0	0	0	1	1	0	0	DACE_DATA
0	0	0	0	1	1	0	1	DACF_DATA
0	0	0	0	1	1	1	0	DACG_DATA
0	0	0	0	1	1	1	1	DACH_DATA

Table 8. レジスタ・マップ

コマンド・ビット	データ・ビット												
	MSDB				LSDB								
B19 - B16	B15 - B12	B11	B10	B9	B8	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
DEVICE_CONFIG	x	0	0	0	PDN-All	PDNH	PDNG	PDNF	PDNE	PDND	PDNC	PDNB	PDNA
STATUS/TRIGGER	x	DEVICE_ID						x	x	SW_RST			
BRDCAST	x	BRDCAST_DATA[9:0] / BRDCAST_DATA[7:0] – MSB 左揃え										x	x
DACA_DATA	x	DACA_DATA[9:0] / DACA_DATA[7:0] – MSB 左揃え										x	x
DACB_DATA	x	DACB_DATA[9:0] / DACB_DATA[7:0] – MSB 左揃え										x	x
DACC_DATA	x	DACC_DATA[9:0] / DACC_DATA[7:0] – MSB 左揃え										x	x
DACD_DATA	x	DACD_DATA[9:0] / DACD_DATA[7:0] – MSB 左揃え										x	x
DACE_DATA	x	DACE_DATA[9:0] / DACE_DATA[7:0] – MSB 左揃え										x	x
DACF_DATA	x	DACF_DATA[9:0] / DACF_DATA[7:0] – MSB 左揃え										x	x
DACG_DATA	x	DACG_DATA[9:0] / DACG_DATA[7:0] – MSB 左揃え										x	x
DACH_DATA	x	DACH_DATA[9:0] / DACAH_DATA[7:0] – MSB 左揃え										x	x

表 9. DACx3608 レジスタ名

オフセット	略称	レジスタ名	セクション
01h	DEVICE_CONFIG	デバイス構成レジスタ	DEVICE_CONFIG レジスタ (オフセット = 01h) [リセット = 00FFh]

Copyright © 2018, Texas Instruments Incorporated

表 9. DACx3608 レジスタ名 (continued)

オフセット	略称	レジスタ名	セクション
02h	STATUS/TRIGGER	状態およびトリガ・レジスタ	STATUS/TRIGGER レジスタ (オフセット = 02h) [リセット = 0300h (DAC53608)、リセット = 0500h (DAC43608)]
03h	BRDCAST	ブロードキャスト・データ・レジスタ	BRDCAST レジスタ (オフセット = 03h) [リセット = 0000h]
08h - 0Fh	DACn_DATA	DACn データ・レジスタ	DACn_DATA レジスタ (オフセット = 08h ~ 0Fh) [リセット = 0000h]

8.6.1 DEVICE_CONFIG レジスタ (オフセット = 01h) [リセット = 00FFh]

図 60. DEVICE_CONFIG レジスタ

15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Don't Care				0	0	0	PDN-AlII	PDNH	PDNG	PDNF	PDNE	PDND	PDNC	PDNB	PDNA
$\overline{W}$							R/$\overline{W}$								

表 10. DEVICE_CONFIG レジスタ・フィールドの説明

ビット	フィールド	種類	リセット	説明
15-12	Don't Care	$\overline{W}$	0h	Don't Care
11-9	予約	$\overline{W}$	00	予約
8	PDN-All	R/$\overline{W}$	0	グローバル・パワーダウン・ビット、「1」に設定すると、全チャネルおよび全バイアス・ブロックがパワーダウンします。
7-0	PDNn	R/$\overline{W}$	FFh	このビットを「1」に設定すると (デフォルト)、DACn がパワーダウン・モードになります (出力バッファが A_{GND} に対して 10K にパワーダウン)。全出力チャネルのバッファ・アンプが 10K モードにパワーダウンした状態で起動し、これらのレジスタに 0 を書き込んでパワーアップ・コマンドが発行されるまでその状態を維持します。

8.6.2 STATUS/TRIGGER レジスタ (オフセット = 02h) [リセット = 0300h (DAC53608)、リセット = 0500h (DAC43608)]

図 61. STATUS/TRIGGER レジスタ

15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Don't Care				DEVICE_ID						Don't Care	Don't Care	SW_RST			
$\overline{W}$				R						$\overline{W}$	$\overline{W}$	$\overline{W}$			

表 11. STATUS/TRIGGER レジスタ・フィールドの説明

ビット	フィールド	種類	リセット	説明
15-12	Don't Care	$\overline{W}$	0h	Don't Care
11-6	DEVICE_ID	R	DAC53608: 001100 DAC43608: 010100	デバイス識別番号 DAC53608: 001100 DAC43608: 010100
5-4	Don't Care	$\overline{W}$	0h	Don't Care
3-0	SW_RST	$\overline{W}$	0h	このレジスタを 1010 に設定すると、デバイスがデフォルト値にリセットされます。

Copyright © 2018, Texas Instruments Incorporated

8.6.3 BRDCAST レジスタ (オフセット = 03h) [リセット = 0000h]

図 62. BRDCAST レジスタ

15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Don't Care				BRDCAST_DATA[9:0] / BRDCAST_DATA[7:0] – MSB 左揃え										Don't Care	Don't Care
W				W										W	W

表 12. BRDCAST レジスタ・フィールドの説明

ビット	フィールド	種類	リセット	説明
15-12	Don't Care	W	0h	Don't Care
11-2	BRDCAST_DATA[9:0] / BRDCAST_DATA[7:0]	W	000h	BRDCAST レジスタに書き込むことにより、DAC チャネルがそのアクティブなレジスタ・データを BRDCAST_DATA のものに更新するように強制します。 データはストレート・バイナリ形式で MSB 揃えとし、次の形式に従います。 DAC53608: { DATA[9:0] } DAC43608: { DATA[7:0], x, x } x – Don't Care ビット
1-0	Don't Care	W	00	Don't Care

8.6.4 DACn_DATA レジスタ (オフセット = 08h ~ 0Fh) [リセット = 0000h]

図 63. DACn_DATA レジスタ

15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Don't Care				BRDCAST_DATA[9:0] / BRDCAST_DATA[7:0] – MSB 左揃え										Don't Care	Don't Care
W				W										W	W

表 13. DACn_DATA レジスタ・フィールドの説明

ビット	フィールド	種類	リセット	説明
15-12	Don't Care	W	0h	Don't Care
11-2	DACn_DATA[9:0] / DACn_DATA[7:0]	W	000h	DACn_DATA レジスタに書き込むことにより、各 DAC チャネルがそのアクティブなレジスタ・データを DACn_DATA に更新するように強制します。 データはストレート・バイナリ形式で MSB 揃えとし、次の形式に従います。 DAC53608: { DATA[9:0] } DAC43608: { DATA[7:0], x, x } x – Don't Care ビット
1-0	Don't Care	W	00	Don't Care

Copyright © 2018, Texas Instruments Incorporated

9 アプリケーションと実装

注

以降のアプリケーション情報は、TIの製品仕様に含まれるものではなく、TIではその正確性または完全性を保証いたしません。個々の目的に対する製品の適合性については、お客様の責任で判断していただくことになります。お客様は自身の設計実装を検証しテストすることで、システムの機能を確認する必要があります。

9.1 アプリケーション情報

DACx3608 は、小型の 3X3 パッケージで供給される、8 チャネル、低消費電力のバッファ付き出力 DAC です。マルチチャネル、低消費電力、小型のパッケージを特長とするこの DAC は、幅広い最終機器のさまざまな用途に適しています。最も一般的な用途は、多機能プリンタの LED バイアス、プログラマブル・コンパレータによる電源管理、高精度回路のオフセットおよびゲイン調整、電源マージニングなどです。

9.2 代表的なアプリケーション

9.2.1 プログラマブル LED バイアス

多機能プリンタ、プロジェクタ、EPOS などの最終機器は、LED による安定した光度を必要とします。図 64 に DACx3608 を使用した LED バイアスの概略回路図を示します。

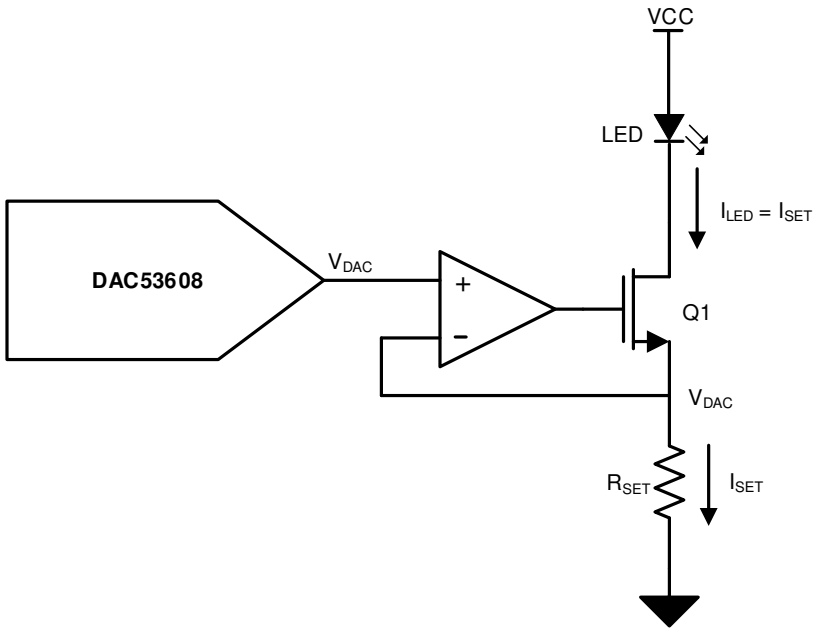


図 64. LED のバイアス印加

9.2.1.1 設計要件

- 一端が電源に接続された LED を流れるプログラム可能な定電流
- DAC の出力範囲:0～5V
- LED の電流範囲:0～20mA

代表的なアプリケーション (continued)

9.2.1.2 詳細な設計手順

ユニティ・ゲイン・バッファを使用した MOSFET のソース電流の設定に DAC を使います (図 64 参照)。LED は、電源と MOSFET のドレインの間に接続します。この構成により、LED に流れる電流量を DAC で制御または設定できます。DAC に接続したバッファが、帰還ループ内で MOSFET のゲート・ソース電圧を制御することで、電圧降下とそれに付随する MOSFET の温度、電流、経年変化によるドリフトを補償できます。DAC で設定する LED 電流は式 2 により計算できます。DAC の出力範囲の 0～5V から 0～20mA を生成するには、250Ω の R_{SET} が必要です。

$$I_{SET} = \frac{V_{DAC}}{R_{SET}} \tag{2}$$

LED バイアス用の疑似コードは以下のとおりです。

```
//SYNTAX: WRITE <REGISTER NAME(Hex Code)>, <DATA>
//Power-up the device and channels
WRITE DEVICE_CONFIG(0x01), 0x0000
//Program mid code (or the desired voltage) on all channels
WRITE DACA_DATA(0x08), 0x07FC //10-bit MSB aligned
WRITE DACB_DATA(0x09), 0x07FC //10-bit MSB aligned
WRITE DACC_DATA(0x0A), 0x07FC //10-bit MSB aligned
WRITE DACD_DATA(0x0B), 0x07FC //10-bit MSB aligned
WRITE DACE_DATA(0x0C), 0x07FC //10-bit MSB aligned
WRITE DACF_DATA(0x0D), 0x07FC //10-bit MSB aligned
WRITE DACG_DATA(0x0E), 0x07FC //10-bit MSB aligned
WRITE DACH_DATA(0x0F), 0x07FC //10-bit MSB aligned
```

9.2.1.3 アプリケーション曲線

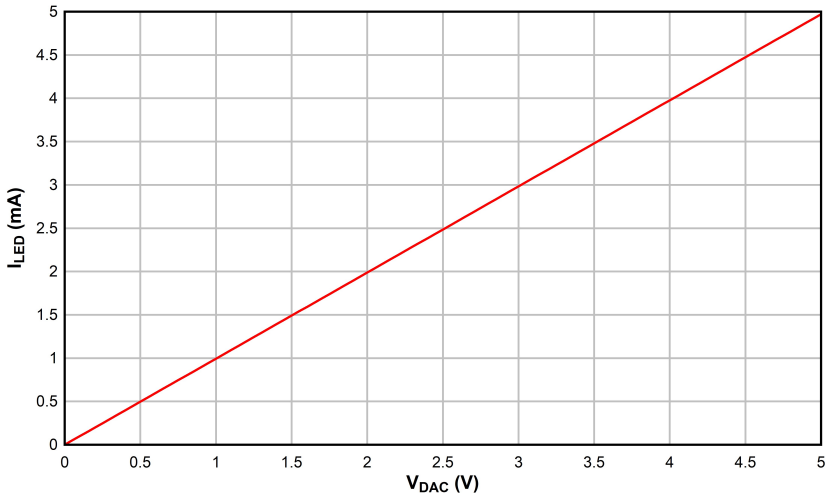


図 65. LED バイアス回路の DC 伝達特性

Copyright © 2018, Texas Instruments Incorporated

代表的なアプリケーション (continued)

9.2.2 プログラマブル・ウィンドウ・コンパレータ

ネットワーク・サーバーや光モジュールといった集中電源を使用する最終機器は、部品を保護するために電力バスを監視する必要があります。この監視または管理を、ウィンドウ・コンパレータを使用して実現します。ウィンドウ・コンパレータは、上限 / 下限スレッショルド超過の信号入力を監視します。スレッショルド超過が発生すると、トリガ信号が生成されます。モジュールで利用可能なすべての電源を管理するには、マルチチャネル監視が必要です。DACx3608 を使うと、使いやすく占有面積の小さい方法でこの要件を満たすことができます。

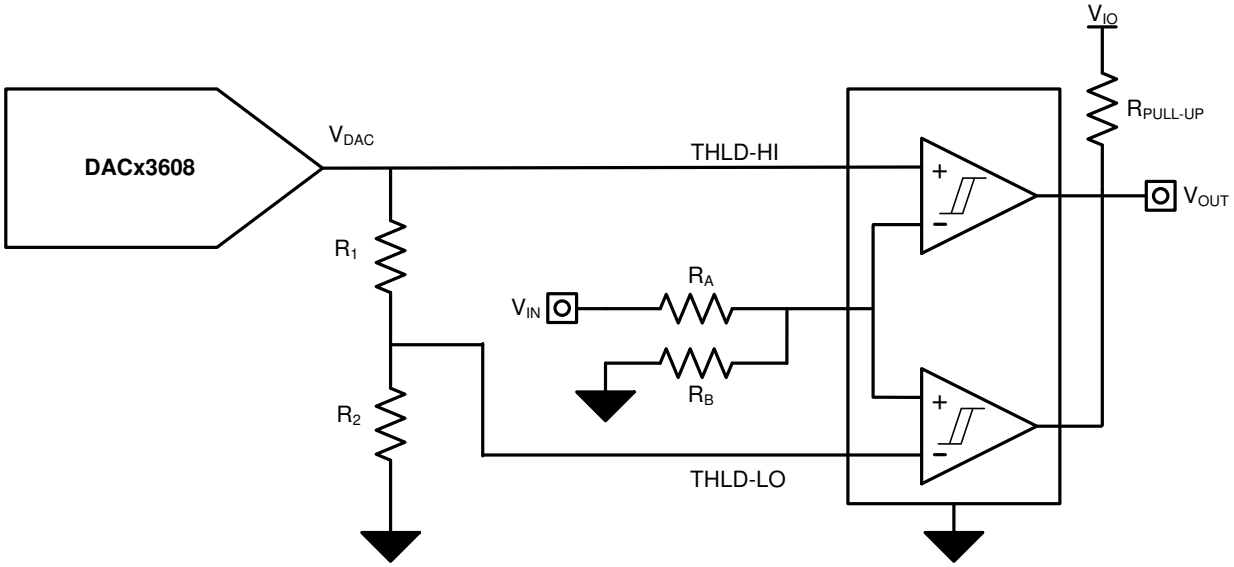


図 66. プログラマブル・ウィンドウ・コンパレータ

9.2.2.1 設計要件

- 監視対象電圧:5V
- High スレッショルド:5V + 10%
- Low スレッショルド:5V – 10%
- トリガ出力:3.3V オープン・ドレイン・シングル出力

9.2.2.2 詳細な設計手順

図 66 に、1 つの DAC チャネルを使用して High スレッショルドと Low スレッショルドの両方を比較する例を示します。図のように、DAC チャネルごとにデュアル・コンパレータを使用します。抵抗 R_A と R_B からなる分圧器を使用して、信号レベルが DAC の範囲内に収まるようにします。また、抵抗 R_1 と R_2 のペアを High スレッショルドの係数として使い、Low スレッショルドを設定します。この構成により、1 つの DAC チャネルを使用して High スレッショルド・レベルと Low スレッショルド・レベルの両方を監視できます。次の利点を得るため、コンパレータはオープン・ドレインとする必要があります。

- 監視プロセッサに適したロジック出力レベルを生成する
- シングル・トリガを生成するために 2 つの出力を短絡できる

図 66 に示す回路では、信号入力が High および Low スレッショルド・レベルを超えない限り、回路の出力は HIGH のままです。どちらかのスレッショルドにかかった時点で、出力は LOW になります。式 3 により、DAC で設定した High スレッショルドから Low スレッショルド電圧を計算できます。

$$V_{THLD\text{-}LO} = V_{DAC} \times \left(\frac{R_2}{R_1 + R_2} \right) \quad (3)$$

代表的なアプリケーション (continued)

5V 電源が ±10% 以内であることを監視するために、公称値が DAC ミッドコードになるように設定することを推奨します。DACx3608 の出力範囲が 0～5V であるため、ミッドコード電圧出力は 2.5V とします。したがって、R_A と R_B は、比較対象電圧が 2.5V になるように選定できます。この例では、R_A と R_B は等しいため、どちらにも 10kΩ の抵抗を使用できます。DACx3608 の 1 つのチャネルを $V_{THLD-HI}$ にプログラムする必要があります。例えば 2.5V + 5% = 2.625V。これは 10 ビットの DAC コードである (2^{10}÷5V) × 2.625V = 537.6 (0x21 Ah) に相当します。2.625V から $V_{THLD-LO}$ (例：2.5V – 5% = 2.405V) を生成するため、式 3 を用いて、R_1 と R_2 の値はそれぞれ 7.5kΩ、82kΩ と計算できます。プログラマブル・ウィンドウ・コンパレータ用の疑似コードと目的の DAC 値を以下に示します。

```
//SYNTAX: WRITE <REGISTER NAME(Hex Code)>, <DATA>
//Power-up the device and channels
WRITE DEVICE_CONFIG(0x01), 0x0000
//Program 2.625V on channel A
WRITE DACA_DATA(0x08), 0x0868 //10-bit MSB aligned
```

9.2.2.3 アプリケーション曲線

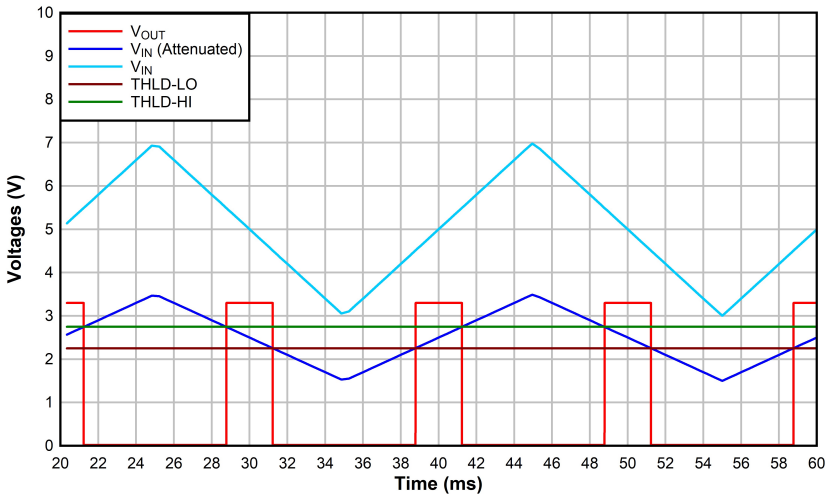


図 67. プログラマブル・コンパレータの出力波形

10 電源に関する推奨事項

DACx3608 ファミリは電源シーケンスを必要としません。単一電源、V_{DD} が必要です。V_{DD} ピンには、0.1µF のデカップリング・コンデンサを推奨します。

Copyright © 2018, Texas Instruments Incorporated

11 レイアウト

11.1 レイアウトの注意点

DACx3608 のピン配置では、レイアウトを最適化できるようにアナログ・ピン、デジタル・ピン、電源ピンを離しています。信号品質を確保するため、デジタル・トレースとアナログ・トレースを離し、デカップリング・コンデンサをデバイス・ピンの近くに配置することを推奨します。

11.2 レイアウト例

図 68 に、デカップリング・コンデンサとプルアップ抵抗を含むレイアウト図の一例を示します。

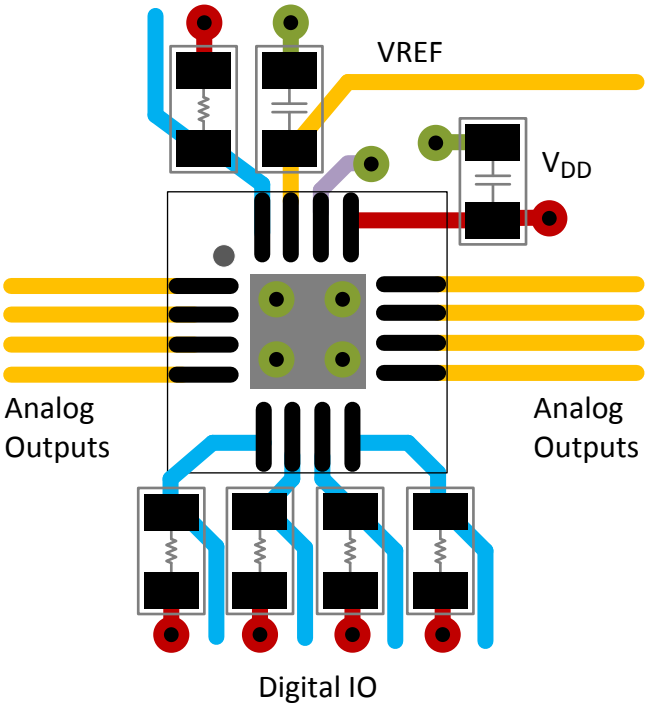


図 68. レイアウト例

Copyright © 2018, Texas Instruments Incorporated

12 デバイスおよびドキュメントのサポート

12.1 ドキュメントのサポート

12.1.1 関連資料

関連資料については、以下を参照してください。『*DAC53608EVM ユーザー・ガイド*』(SLAU790)

12.2 関連リンク

次の表に、クイック・アクセス・リンクを示します。カテゴリには、技術資料、サポートおよびコミュニティ・リソース、ツールとソフトウェア、およびサンプル注文またはご購入へのクイック・アクセスが含まれます。

表 14. 関連リンク

製品	プロダクト・フォルダ	ご注文はこちら	技術資料	ツールとソフトウェア	サポートとコミュニティ
DAC53608	ここをクリック	ここをクリック	ここをクリック	ここをクリック	ここをクリック
DAC43608	ここをクリック	ここをクリック	ここをクリック	ここをクリック	ここをクリック

12.3 ドキュメントの更新通知を受け取る方法

ドキュメントの更新についての通知を受け取るには、ti.comのデバイス製品フォルダを開いてください。右上の隅にある「*通知を受け取る*」をクリックして登録すると、変更されたすべての製品情報に関するダイジェストを毎週受け取れます。変更の詳細については、修正されたドキュメントに含まれている改訂履歴をご覧ください。

12.4 コミュニティ・リソース

The following links connect to TI community resources. Linked contents are provided "AS IS" by the respective contributors. They do not constitute TI specifications and do not necessarily reflect TI's views; see TI's Terms of Use.

TI E2E™オンライン・コミュニティ ***TIのE2E (Engineer-to-Engineer) コミュニティ。*** エンジニア間の共同作業を促進するために開設されたものです。e2e.ti.comでは、他のエンジニアに質問し、知識を共有し、アイディアを検討して、問題解決に役立てることができます。

設計サポート ***TIの設計サポート*** 役に立つE2Eフォーラムや、設計サポート・ ツールをすばやく見つけることができます。技術サポート用の連絡先情報も参照できます。

12.5 商標

E2E is a trademark of Texas Instruments.
All other trademarks are the property of their respective owners.

12.6 静電気放電に関する注意事項



すべての集積回路は、適切なESD保護方法を用いて、取扱いと保存を行うようにして下さい。

静電気放電はわずかな性能の低下から完全なデバイスの故障に至るまで、様々な損傷を与えます。高精度の集積回路は、損傷に対して敏感であり、極めてわずかなパラメータの変化により、デバイスに規定された仕様に適合しなくなる場合があります。

12.7 Glossary

SLYZ022 — *TI Glossary*.

This glossary lists and explains terms, acronyms, and definitions.

Copyright © 2018, Texas Instruments Incorporated

13 メカニカル、パッケージ、および注文情報

以降のページには、メカニカル、パッケージ、および注文に関する情報が記載されています。この情報は、そのデバイスについて利用可能な最新のデータです。このデータは予告なく変更されることがあり、ドキュメントが改訂される場合もあります。本データシートのブラウザ版を使用されている場合は、画面左側の説明をご覧ください。

Copyright © 2018, Texas Instruments Incorporated

PACKAGING INFORMATION

Orderable part number	Status (1)	Material type (2)	Package | Pins	Package qty | Carrier	RoHS (3)	Lead finish/ Ball material (4)	MSL rating/ Peak reflow (5)	Op temp (°C)	Part marking (6)
DAC43608RTER	Active	Production	WQFN (RTE) | 16	3000 | LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	D43608
DAC43608RTER.A	Active	Production	WQFN (RTE) | 16	3000 | LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	D43608
DAC43608RTERG4	Active	Production	WQFN (RTE) | 16	3000 | LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	D43608
DAC43608RTERG4.A	Active	Production	WQFN (RTE) | 16	3000 | LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	D43608
DAC43608RTET	Active	Production	WQFN (RTE) | 16	250 | SMALL T&R	Yes	SN	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	D43608
DAC43608RTET.A	Active	Production	WQFN (RTE) | 16	250 | SMALL T&R	Yes	SN	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	D43608
DAC53608RTER	Active	Production	WQFN (RTE) | 16	3000 | LARGE T&R	Yes	SN	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	D53608
DAC53608RTER.A	Active	Production	WQFN (RTE) | 16	3000 | LARGE T&R	Yes	SN	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	D53608
DAC53608RTET	Active	Production	WQFN (RTE) | 16	250 | SMALL T&R	Yes	SN	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	D53608
DAC53608RTET.A	Active	Production	WQFN (RTE) | 16	250 | SMALL T&R	Yes	SN	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	D53608

(1) **Status:** For more details on status, see our product life cycle.

(2) **Material type:** When designated, preproduction parts are prototypes/experimental devices, and are not yet approved or released for full production. Testing and final process, including without limitation quality assurance, reliability performance testing, and/or process qualification, may not yet be complete, and this item is subject to further changes or possible discontinuation. If available for ordering, purchases will be subject to an additional waiver at checkout, and are intended for early internal evaluation purposes only. These items are sold without warranties of any kind.

(3) **RoHS values:** Yes, No, RoHS Exempt. See the TI RoHS Statement for additional information and value definition.

(4) **Lead finish/Ball material:** Parts may have multiple material finish options. Finish options are separated by a vertical ruled line. Lead finish/Ball material values may wrap to two lines if the finish value exceeds the maximum column width.

(5) **MSL rating/Peak reflow:** The moisture sensitivity level ratings and peak solder (reflow) temperatures. In the event that a part has multiple moisture sensitivity ratings, only the lowest level per JEDEC standards is shown. Refer to the shipping label for the actual reflow temperature that will be used to mount the part to the printed circuit board.

(6) **Part marking:** There may be an additional marking, which relates to the logo, the lot trace code information, or the environmental category of the part.

Multiple part markings will be inside parentheses. Only one part marking contained in parentheses and separated by a "~" will appear on a part. If a line is indented then it is a continuation of the previous line and the two combined represent the entire part marking for that device.

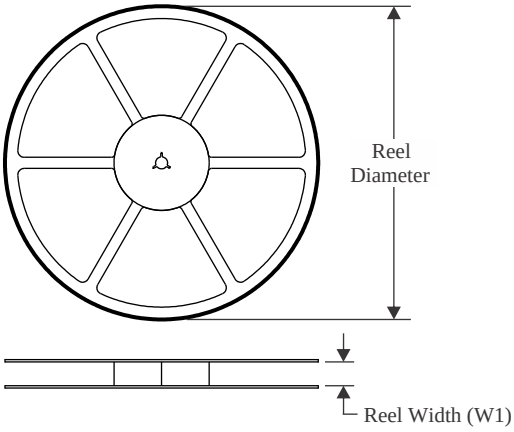
Important Information and Disclaimer: The information provided on this page represents TI's knowledge and belief as of the date that it is provided. TI bases its knowledge and belief on information provided by third parties, and makes no representation or warranty as to the accuracy of such information. Efforts are underway to better integrate information from third parties. TI has taken and continues to take reasonable steps to provide representative

and accurate information but may not have conducted destructive testing or chemical analysis on incoming materials and chemicals. TI and TI suppliers consider certain information to be proprietary, and thus CAS numbers and other limited information may not be available for release.

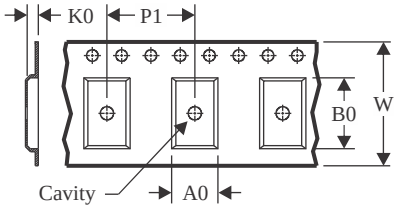
In no event shall TI's liability arising out of such information exceed the total purchase price of the TI part(s) at issue in this document sold by TI to Customer on an annual basis.

TAPE AND REEL INFORMATION

REEL DIMENSIONS

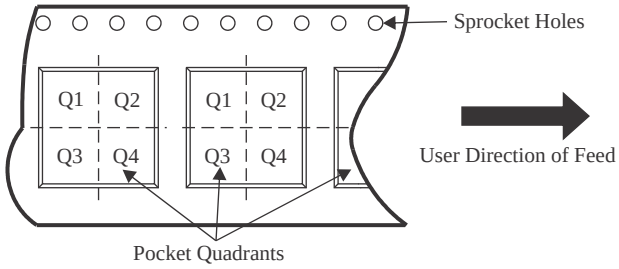


TAPE DIMENSIONS



A0	Dimension designed to accommodate the component width
B0	Dimension designed to accommodate the component length
K0	Dimension designed to accommodate the component thickness
W	Overall width of the carrier tape
P1	Pitch between successive cavity centers

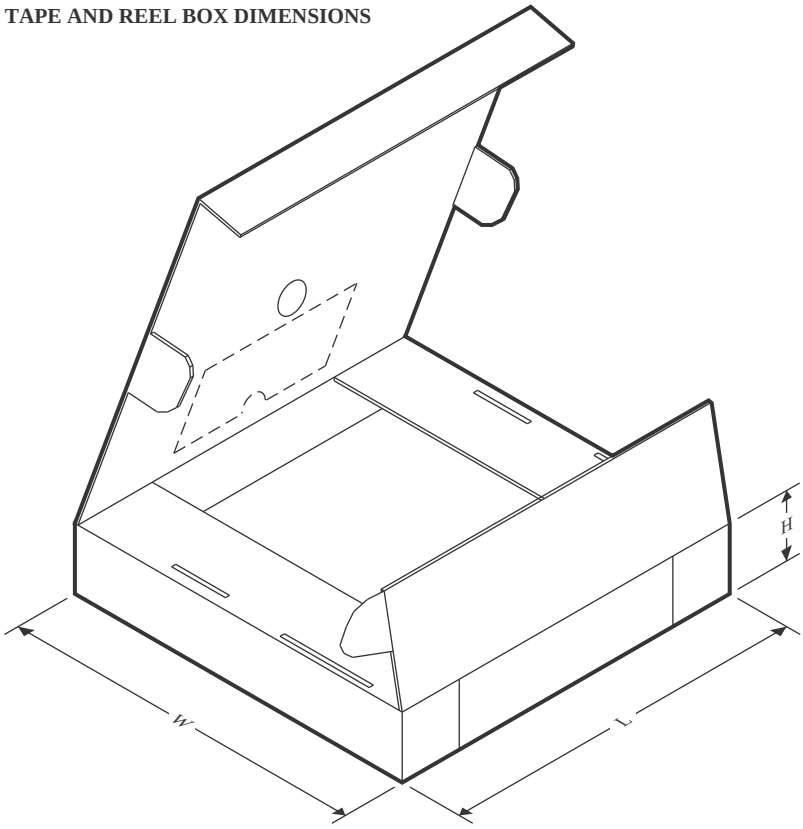
QUADRANT ASSIGNMENTS FOR PIN 1 ORIENTATION IN TAPE



*All dimensions are nominal

Device	Package Type	Package Drawing	Pins	SPQ	Reel Diameter (mm)	Reel Width W1 (mm)	A0 (mm)	B0 (mm)	K0 (mm)	P1 (mm)	W (mm)	Pin1 Quadrant
DAC43608RTER	WQFN	RTE	16	3000	330.0	12.4	3.3	3.3	1.1	8.0	12.0	Q2
DAC43608RTERG4	WQFN	RTE	16	3000	330.0	12.4	3.3	3.3	1.1	8.0	12.0	Q2
DAC43608RTET	WQFN	RTE	16	250	180.0	12.4	3.3	3.3	1.1	8.0	12.0	Q2
DAC53608RTER	WQFN	RTE	16	3000	330.0	12.4	3.3	3.3	1.1	8.0	12.0	Q2
DAC53608RTET	WQFN	RTE	16	250	180.0	12.4	3.3	3.3	1.1	8.0	12.0	Q2

TAPE AND REEL BOX DIMENSIONS



*All dimensions are nominal

Device	Package Type	Package Drawing	Pins	SPQ	Length (mm)	Width (mm)	Height (mm)
DAC43608RTER	WQFN	RTE	16	3000	360.0	360.0	36.0
DAC43608RTERG4	WQFN	RTE	16	3000	367.0	367.0	35.0
DAC43608RTET	WQFN	RTE	16	250	210.0	185.0	35.0
DAC53608RTER	WQFN	RTE	16	3000	360.0	360.0	36.0
DAC53608RTET	WQFN	RTE	16	250	210.0	185.0	35.0

GENERIC PACKAGE VIEW

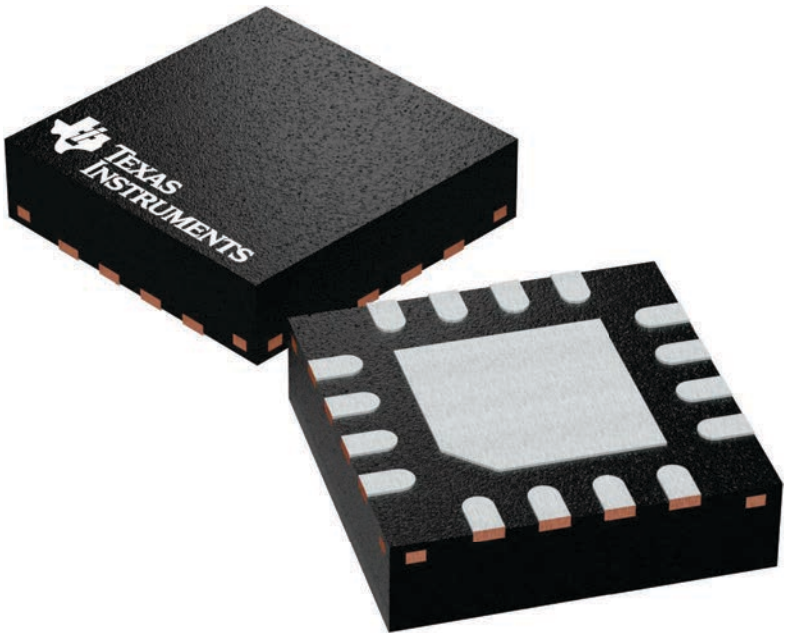
RTE 16

WQFN - 0.8 mm max height

3 x 3, 0.5 mm pitch

PLASTIC QUAD FLATPACK - NO LEAD

This image is a representation of the package family, actual package may vary.
Refer to the product data sheet for package details.

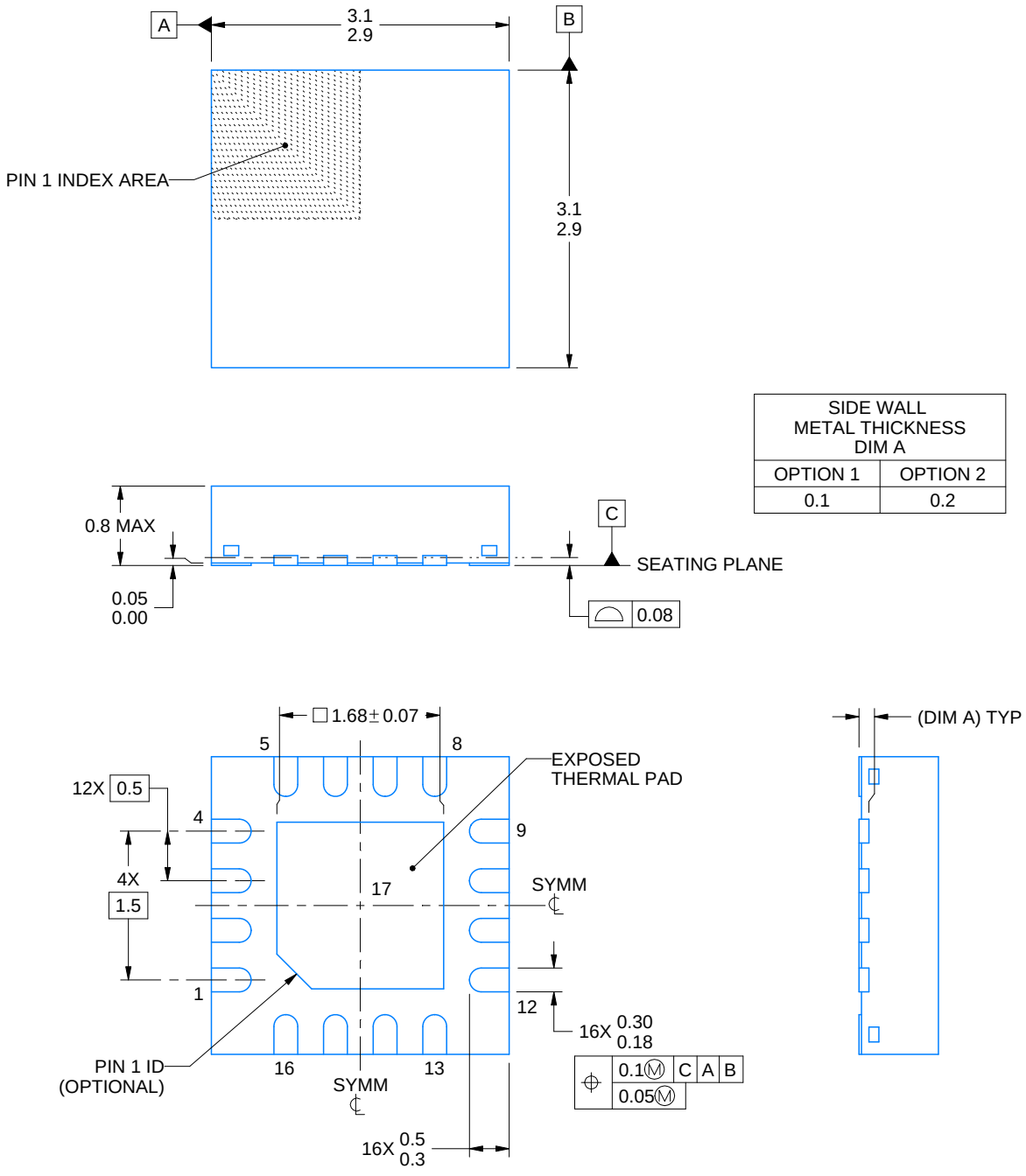


RTE0016C

PACKAGE OUTLINE

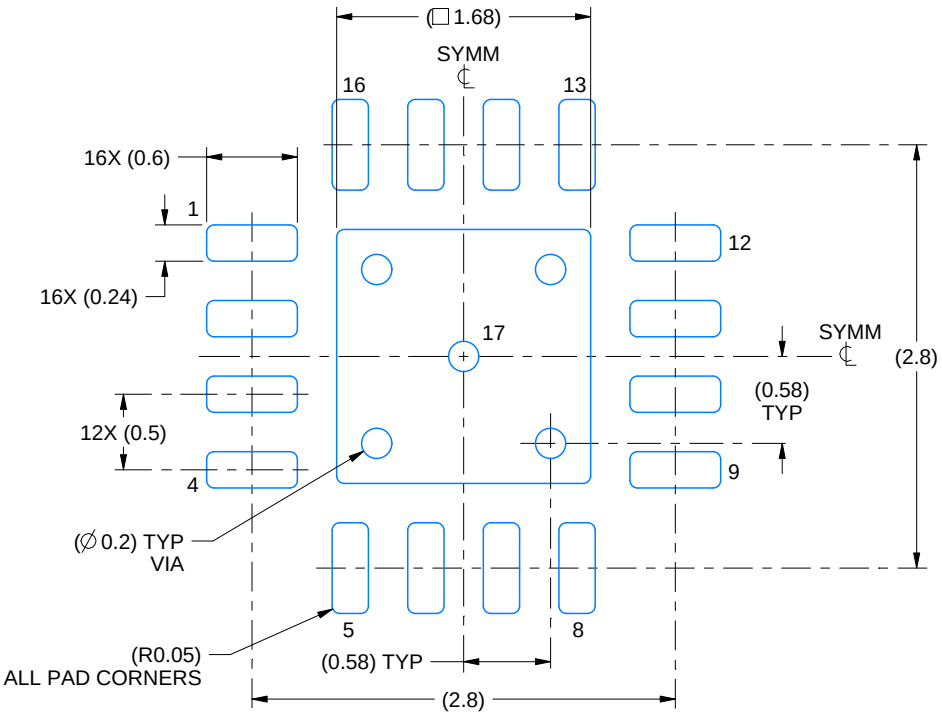
WQFN - 0.8 mm max height

PLASTIC QUAD FLATPACK - NO LEAD

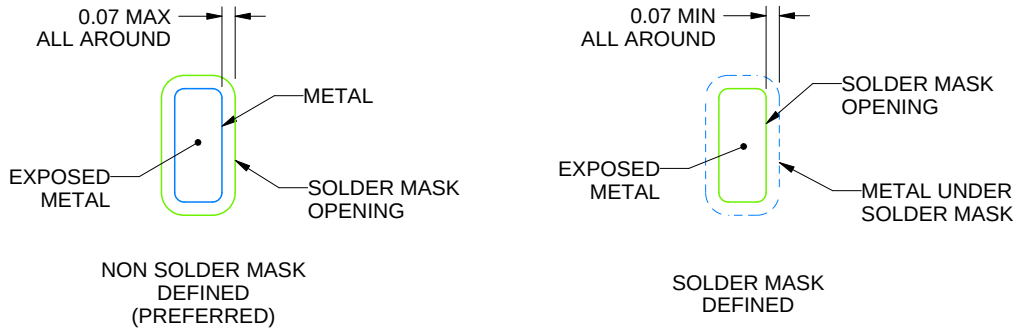


NOTES:

1. All linear dimensions are in millimeters. Any dimensions in parenthesis are for reference only. Dimensioning and tolerancing per ASME Y14.5M.
2. This drawing is subject to change without notice.
3. The package thermal pad must be soldered to the printed circuit board for thermal and mechanical performance.



LAND PATTERN EXAMPLE
EXPOSED METAL SHOWN
SCALE:20X

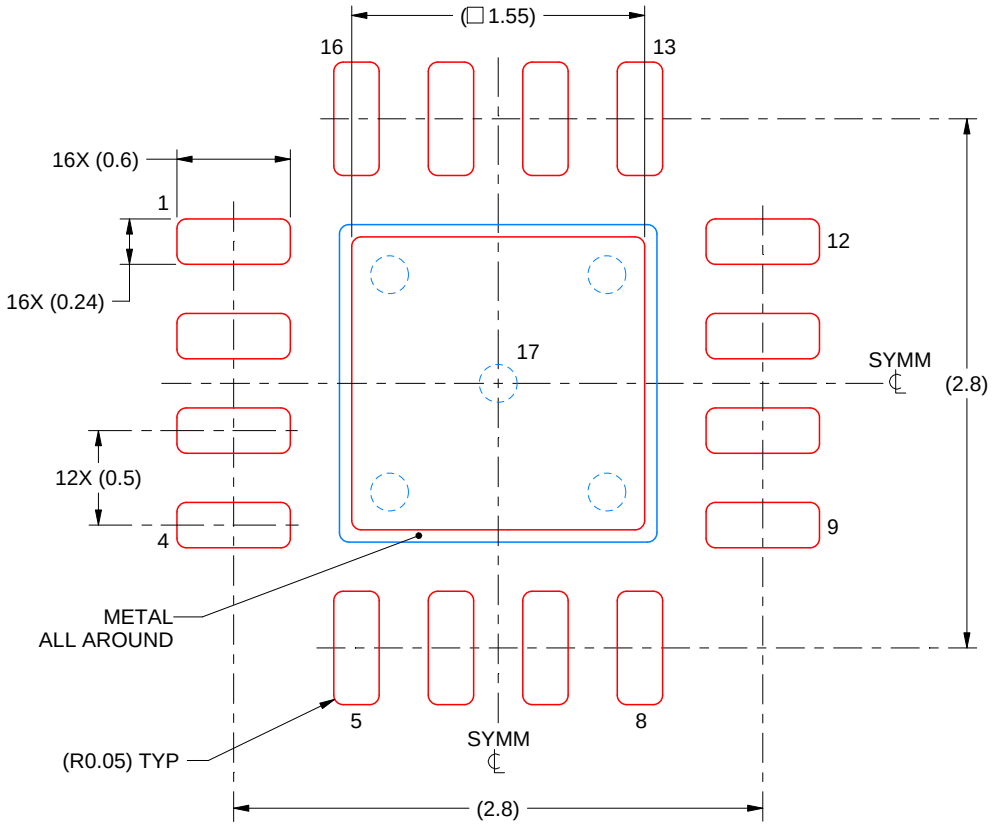


SOLDER MASK DETAILS

4219117/B 04/2022

NOTES: (continued)

4. This package is designed to be soldered to a thermal pad on the board. For more information, see Texas Instruments literature number SLUA271 (www.ti.com/lit/slua271).
5. Vias are optional depending on application, refer to device data sheet. If any vias are implemented, refer to their locations shown on this view. It is recommended that vias under paste be filled, plugged or tented.



SOLDER PASTE EXAMPLE
BASED ON 0.125 mm THICK STENCIL

EXPOSED PAD 17:
85% PRINTED SOLDER COVERAGE BY AREA UNDER PACKAGE
SCALE:25X

4219117/B 04/2022

NOTES: (continued)

6. Laser cutting apertures with trapezoidal walls and rounded corners may offer better paste release. IPC-7525 may have alternate design recommendations.

重要なお知らせと免責事項

TI は、技術データと信頼性データ (データシートを含みます)、設計リソース (リファレンス デザインを含みます)、アプリケーションや設計に関する各種アドバイス、Web ツール、安全性情報、その他のリソースを、欠陥が存在する可能性のある「現状のまま」提供しており、商品性および特定目的に対する適合性の黙示保証、第三者の知的財産権の非侵害保証を含むいかなる保証も、明示的または黙示的にかかわらず拒否します。

これらのリソースは、TI 製品を使用する設計の経験を積んだ開発者への提供を意図したものです。(1) お客様のアプリケーションに適した TI 製品の選定、(2) お客様のアプリケーションの設計、検証、試験、(3) お客様のアプリケーションに該当する各種規格や、その他のあらゆる安全性、セキュリティ、規制、または他の要件への確実な適合に関する責任を、お客様のみが単独で負うものとします。

上記の各種リソースは、予告なく変更される可能性があります。これらのリソースは、リソースで説明されている TI 製品を使用するアプリケーションの開発の目的でのみ、TI はその使用をお客様に許諾します。これらのリソースに関して、他の目的で複製することや掲載することは禁止されています。TI や第三者の知的財産権のライセンスが付与されている訳ではありません。お客様は、これらのリソースを自身で使用した結果発生するあらゆる申し立て、損害、費用、損失、責任について、TI およびその代理人を完全に補償するものとし、TI は一切の責任を拒否します。

TI の製品は、 TI の販売条件 、 TI の総合的な品質ガイドライン 、 ti.com または TI 製品などに関連して提供される他の適用条件に従い提供されます。TI がこれらのリソースを提供することは、適用される TI の保証または他の保証の放棄の拡大や変更を意味するものではありません。 TI がカスタム、またはカスタマー仕様として明示的に指定していない限り、TI の製品は標準的なカタログに掲載される汎用機器です。

お客様がいかなる追加条項または代替条項を提案する場合も、TI はそれらに異議を唱え、拒否します。

Copyright © 2026, Texas Instruments Incorporated

最終更新日：2025 年 10 月